



**JPCA 2014 Show**  
**第44回国際電子回路産業展**  
 44th International Electronic Circuits Exhibition  
 主催：一般社団法人日本電子回路工業会  
 Sponsored by JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association

■構成展示会

- 2014プリント配線板技術展  
PWB Technology 2014
- 2014半導体パッケージング・部品内蔵技術展  
Module Japan 2014
- 2014機器・半導体受託生産システム展  
EMS Japan 2014

  
**ラージエレクトロニクスショー2014**  
 主催：一般社団法人日本電子回路工業会・一般社団法人日本電子回路工業会  
 Co-Sponsored by:  
 JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association  
 The Semiconductor Industry News Company (SINC)  
**Large Electronics Show 2014**

■構成展示会

- 2014プリントエレクトロニクス最適生産システム展  
PE PROCESS 2014
- 2014LED/OLED応用技術展  
SS (Solid-State) Lighting 2014
- 2014部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展  
Device Engineering 2014

  
**WIRE Japan Show 2014**  
 電線・ケーブル・コネクタ総合技術展  
 主催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞(株)工業通信  
 Electric Wire, Cable, Connector Exhibition  
 Co-Sponsored by:  
 JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association  
 THE ELECTRIC WIRE & CABLE NEWS (KOGYO TSUSHIN CO., LTD.)

  
**JIEP 2014**  
 マイクロエレクトロニクスショー  
**第28回 最先端実装技術・パッケージング展**  
 28th ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION  
 主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)  
 Sponsored by: Japan Institute of Electronics Packaging

  
**JISSO PROTEC 2014**  
**第16回 実装プロセステクノロジー展**  
 16th Jisso Process Technology Exhibition  
 主催：一般社団法人日本ロボット工業会  
 Sponsored by: JARA

**6.4Wed. – 6Fri.** 10:00 a.m. – 5:00 p.m.  
 At Tokyo Big Sight

# はじめに

一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA) 主催「JPCA Show 2014 第44回国際電子回路産業展」、JPCAと半導体産業新聞 (株式会社産業タイムズ) が共催する「ラージエレクトロニクスショー2014」、一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP) 主催「2014マイクロエレクトロニクスショー 第28回最先端実装技術・パッケージング展」と一般社団法人日本ロボット工業会 (JARA) 主催の「JISSO PROTEC 2014 第16回実装プロセステクノロジー展」、本年より新たに加わったJPCAと電線新聞 (株式会社工業通信) が共催する電線/ケーブル・コネクタ・周辺機器の日本唯一の展示会「WIRE Japan Show 2014」は、2014年6月4日 (水) から6月6日 (金) の3日間、東京ビッグサイトにおいて開催され、無事終えることが出来ました。これらも偏に、ご出展各社並びに関係各位のご協力の賜物と深く御礼申し上げます。

本年度はあらゆる製品・技術を「載せる つなぐ つくる そして、ひろげる」をテーマに周辺境界領域とのコラボを実践するべく、展示会全体基調講演とJIEP主催の最先端実装技術シンポジウムの講演テーマの関連性強化、CIPA ((一社)カメラ映像機器工業会) の特別協力によるCIPAパネルディスカッションの実施、JASA ((一社)組込みシステム技術協会) 主催の日本プラグフェストセミナー・クローズドイベントの実施、NEDIA ((一社)日本電子デバイス産業協会) の特別協力によるNEDIAパビリオンの設置、JMID (日本MID協会) 主催の3D-MIDパビリオンセミナーの実施、産業技術総合研究所の特別協力による展示、SEMIジャパンの特別協力等、数々のコラボを実現し、電子回路基板・実装主体から電子回路総合展へと大きく刷新し、今まで以上に幅広いご出展各位、協力団体各位、主催5団体一丸となって国内外に向けた様々な情報発信を実施致しました。

特に、5展示会の共通の合言葉を「日本をもっと! 元気にする」とし、日本のものづくりはどう在るべきか、「医療・ヘルスケア」「3Dプリンター」「自動車」「ビッグデータ」「ウェアラブル」等、現在各業界が大変注目を集めているテーマにて基調講演を開催した他、例年大好評頂いている、デジタルカメラ特別パネルディスカッションを世界トップクラスの企業様にご登壇頂き「デジタルカメラの動向 (4K・8K時代のデジカメ)」をテーマに実施し、大変多くの方々よりご好評頂きました。

その他、ご来場頂くユーザーの方々が当業界に理解を深めて頂くための、「電子回路業界サプライチェーンiCON展示」を昨年に引き続き実施。ユーザーフレンドリーな展示会として、ご来場ユーザーが求める機能別対策技術展示区分アイコンに加え、製品・技術の用途先を明確に表示できる用途別展示区分アイコン、従来比生産性30%UPを実現する製品、技術の高い生産性のアピールにご利用頂けるダントツ生産性アイコン等、対応する各出展製品の表示が可能となる「アイコンデータ」と、各ブースにて対応可能な言語を表示できる「各ブース対応可能言語卓上POP印刷用データ」を提供し、出展各位のご協力のもとユーザーに優しい会場レイアウトの実施に努めました。

また、経済産業省のトップである茂木大臣にJPCA小林会長と展示会運営委員会山本委員長が事前に面会し、日本の製造業の一翼を担う電子回路産業の取組みにご理解を賜り、国会会期中のご多忙のところ、ご来賓として展示会開催初日ウェルカムレセプションにご臨席・ご祝辞を頂戴致しました。

今後益々ご出展・ご来場各位のご期待に沿えるよう、次回開催に向けて更なる邁進を遂げる所存でありますので、何卒倍旧のご支援・お力添えをお願い申し上げます。



## CONTENTS 目次

1 実施概要	3	8 オープンセミナー	12
2 会場構成	4	1) NPIプレゼンテーション (出展者新製品・技術紹介セミナー)	12
3 開会式・ウェルカムレセプション	5	2) 第10回JPCA賞 (アワード)	12
4 基調講演・パネルディスカッション	7	3) PROTECセミナー	12
5 第3回プリントエレクトロニクスコンベンション (PEC Japan 2013)	8	4) ぷりんとはんじゆくセミナー	12
6 JIEP最先端実装技術シンポジウム	9	5) 光電子回路実装標準化セミナー	12
7 ものつくりフェスタ2014	9	6) 電子回路基板ワークショップ <b>NEW</b>	12
1) 半導体産業新聞主催「夢をカタチに」		7) WIRE Japan Showセミナー <b>NEW</b>	13
次世代アプリ開発支援のセミナーと特別展示	9	8) 電子回路プラザ	13
2) 第20回半導体・オブ・ザ・イヤー2014 受賞製品・技術発表	10	9) めっき表面処理セミナー	13
3) ダントツ生産性向上パビリオンセミナー <b>NEW</b>	10	10) アカデミックプラザ	13
4) JMID主催 3D-MIDパビリオンセミナー <b>NEW</b>	10	11) アカデミックプラザ賞授賞式	13
5) プラグフェストセミナー <b>NEW</b>	10	12) 第6回JPCAデザインアワード授賞式	13
6) プリント配線板ロードマップセミナー <b>NEW</b>	11	13) IPCはんだ付けコンテスト	13
7) 電子機器分解セミナー・展示	11	9 電子回路営業士・資格フォローアップセミナー	14
8) 実装体験コーナー	11	10 併催JPCA公式国際会議	14
9) UL Forum (旧UL IAG会議) <b>NEW</b>	11	11 展示規模	14
10) IPCAインド投資促進セミナー <b>NEW</b>	11	12 出展者アンケート調査結果	22
11) EMS最前線セミナー		13 来場者サービス	27
~アジア・中国・日本の市場で売れる製品とモノづくり~	11	14 広報活動	28
12) 産業技術総合研究所・特別展示	11	15 スポンサーシップ <b>NEW</b>	29
13) eSurface特別セッション <b>NEW</b>	11	16 出展者一覧	30
		17 2014年展示会主催・運営委員会 委員リスト	31

# 1 実施概要



(一社)日本電子回路工業会  
会長 小林俊文



展示会運営委員会  
委員長 山本治彦



(株)産業タイムズ社  
代表取締役社長 泉谷渉



(株)工業通信  
代表取締役社長 井上政基



(一社)エレクトロニクス実装学会  
会長 須賀唯知



(一社)日本ロボット工業会  
会長 津田純嗣

■ 会 期：2014年6月4日(水)～6月6日(金)

■ 開催時間：午前10時～午後5時

■ 会 場：東京ビッグサイト 東展示棟・東2～6ホール

■ 名 称：**JPCA Show 2014 第44回国際電子回路産業展**

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 **JPCA**

特別協力：EMSONe

構成展示会：2014 プリント配線板技術展 **PLW/B Techn 2014**  
2014 半導体パッケージング・部内蔵技術展 **MP&I JAPAN 2014**  
2014 機器・半導体受託生産システム展 **EMSONe**

**ラージエレクトロニクスショー2014**

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 **JPCA**

半導体産業新聞(株)産業タイムズ社

構成展示会：2014 プリンテッドエレクトロニクス最適生産システム展 **PE PROCESS 2014**  
2014 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展 **D Device Engineering 2014**  
2014 LED/OLED 応用技術展 **SS SS Lighting 2014**

■ 同時開催：ものづくりフェスタ2014

第3回プリンテッドエレクトロニクスコンベンションジャパン(PEC Japan 2014)

■ 目 的：あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や将来に渡り広く使用・普及されるラージエレクトロニクス(プリンテッドエレクトロニクス、ストレッチャブルエレクトロニクス等)の設計から製造、信頼性確保、流通に至る製品展示により技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。

■ 後 援：経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部

■ 特別協力：一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)、一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)、一般社団法人日本銅センター(JCDA)、一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)、SEMIジャパン

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会 **WECC** 加盟団体—**CPCA**-中国印制電路行業協會、**EIPC**-欧州電子回路協会、**HKPCA**-香港線路板協會、

**IPC**-米国電子回路協会、**IPC**-インド電子回路工業会、**KPCA**-韓国電子回路産業協會、**TPCA**-台湾電路板協會、**JPCA**-日本電子回路工業会

■ 運 営：一般社団法人日本電子回路工業会 **JPCA**

■ 協 賛：RP産業協会、宇宙航空研究開発機構、映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、画像電子学会、カメラ映像機器工業会、組込みシステム技術協会、合成樹脂工業協会、産業安全技術協会、産業技術総合研究所、自動車技術会、写真感光材料工業会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国鍍金工業組合連合会、T-Engineフォーラム、電気安全環境研究所、電気学会、電気機能材料工業会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、電池工業会、銅箔工業会、日本アミューズメントマシン協会、日本医用光学機器工業会、日本医療機器工業会、日本医療器材工業会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本界面活性剤工業会、日本化学工業協会、日本火災報知機工業会、日本画像医療システム工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本光学測定機工業会、日本産業機械工業会、日本試験機工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、日本自動認識システム協会、日本照明工業会、日本真空学会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本接着剤工業会、日本セラミックス協会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本電子部品信頼性センター、日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本品質保証機構、日本ファインセラミックス協会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶剤リサイクル工業会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター、マイクロマシンセンター、次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合、太陽光発電技術研究組合、技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター、次世代化学材料評価技術研究組合、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、技術研究組合半層CNT融合新材料研究開発機構、日本材料科学会、情報通信ネットワーク産業協会、コンピュータソフトウェア協会、日本エレクトロニクスショー協会、プリンテッドエレクトロニクス研究会

※法人格の掲載は省略させて頂いております。

順不同、計86団体

■ 展示規模：出展者数 676社・団体 小間数 1,402小間

■ 来場者数：119,220名(実登録者数 37,048名)

NEW

**WIRE Japan Show 2014 電線・ケーブル・コネクタ総合技術展**

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 **JPCA**

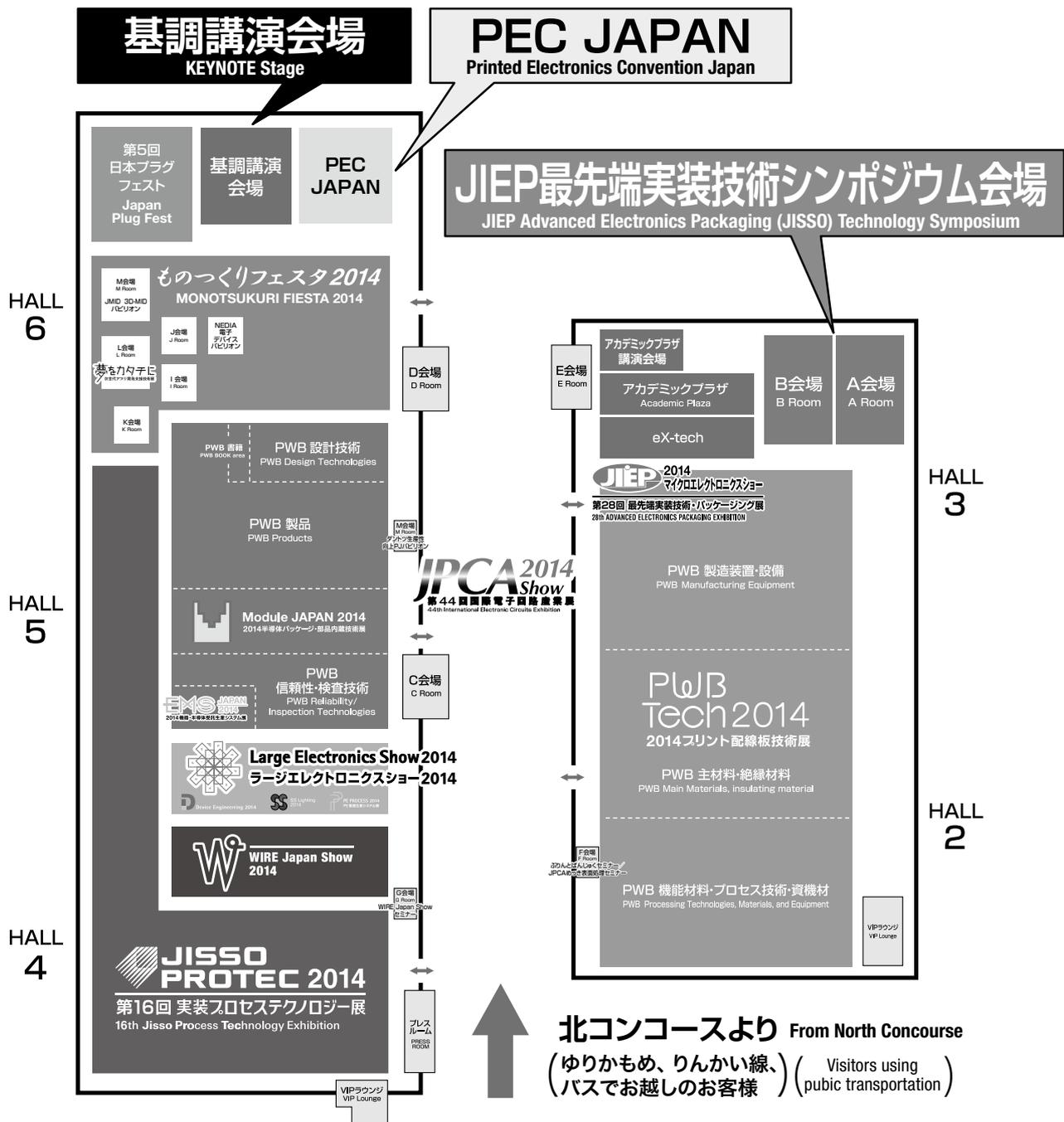
電線新聞(株)工業通信

**2014マイクロエレクトロニクスショー 第28回 最先端実装技術・パッケージング展**

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 **IEA**

**JISSO PROTEC 2014 第16回 実装プロセステクノロジー展**

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会 **JRA**



シンポジウムA会場 Symposium A Room	JIEP最先端実装技術シンポジウム JIEP Advanced Electronics Packaging (JISSO) Technology Symposium
シンポジウムB会場 Symposium B Room	JIEP最先端実装技術シンポジウム JIEP Advanced Electronics Packaging (JISSO) Technology Symposium
C会場	Protec セミナー
C Room	Protec Seminar (Exhibitor's Seminar)
D会場	NPIプレゼンテーション
D Room	NPI Presentation (Exhibitor's Seminar)
E会場	NPIプレゼンテーション
E Room	NPI Presentation (Exhibitor's Seminar)
F会場	ぷりんとばんじゅくセミナー/JPCAめっき表面処理セミナー
F Room	PURINTOBAN・JYUKU Seminar / JPCA Plating/Surface Finishing Technology Seminar
G会場	WIRE Japan Show セミナー
G Room	WIRE Japan Show Seminar

H会場	ダントツ生産性向上プロジェクトパビリオンセミナー
H Room	JPCA Superior DANTOTSU Productivity Project Pavilion Seminar
I会場	電子回路ワークショップ
I Room	Workshop for Electronics Circuits Board
J会場	IPCAセミナー/EMSOOneセミナー
J Room	IPCA Seminar / EMSOne Seminar
K会場	プラグフェストセミナー/電子機器分解セミナー
K Room	JASA Japan Plug Fest Open Seminar / Electronics Products BUNKAI Seminar
L会場	半導体産業新聞主催「夢をカタチに」次世代アプリ開発支援セミナー
L Room	"To realize the dream" Application Software Development Support Seminar for Next-Generation by The Semiconductor Industry News
M会場	JMID主催3D-MID/パビリオンセミナー
M Room	JMID 3D-MID Seminar
実装体験コーナ Electronics Handicraft Class	

# 3 開会式・ウェルカムレセプション

## 開会式

- 日 時：6月4日(水)9:30~10:00
- 会 場：東京ビッグサイト北コンコース メインボード前
- 式次第：開会宣言

一般社団法人日本電子回路工業会  
 展示会運営委員会/展示会企画委員会 委員長 山本 治彦

### 開会挨拶

一般社団法人日本電子回路工業会 会長 小林 俊文

### 開会セレモニー

経済産業省商務情報政策局	デバイス産業戦略室長	宮崎 貴哉
世界電子回路業界団体協議会 (WECC)	事務総長	Rex Rozario
中国印刷電路行業協會 (CPCA)	理事長	由 鏞
香港線路板協會 (HKPCA)	副理事長	李 木金
米国電子回路協會 (IPC)	専務理事	John Mitchell
インド電子回路工業会 (IPCA)	会長	Viral Bhulani
韓国電子回路産業協會 (KPCA)	会長	金 京熙
台湾電路板協會 (TPCA)	理事長	Rick Wu
一般社団法人日本電子回路工業会	会長	小林 俊文
一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長	小岩 一郎
一般社団法人日本ロボット工業会	副会長	藤田 宏昭
株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長	泉谷 涉
株式会社工業通信	代表取締役社長	井上 政基
一般社団法人日本電子回路工業会	副会長	山下 博樹
一般社団法人日本電子回路工業会	副会長	岩城 慶太郎
一般社団法人日本電子回路工業会	副会長	東入來 信博
一般社団法人日本電子回路工業会	副会長	山脇 昇
展示会運営委員会/展示会企画委員会	委員長	山本 治彦
展示会運営委員会	副委員長	曾谷 太
展示会運営委員会	副委員長	四津 三樹男
JIEP展示事業委員会	委員長	土門 孝彰
JISSO PROTEC 2014 運営委員会	委員長	曾我 信之
JISSO PROTEC 2014 運営委員会	委員	永嶋 弘和
JISSO PROTEC 2014 運営委員会	委員	尾本 勝彦
JISSO PROTEC 2014 実行委員会	委員長	武野 祐丸

(敬称略)



開会宣言 (山本委員長)



開催挨拶 (小林会長)



開会式の様子

# ウェルカムレセプション

## ウェルカムレセプションに茂木経産大臣がご臨席、祝辞を述べる

経済産業省のトップである茂木経済産業大臣にJPCA小林会長と展示会運営委員会 山本委員長が事前に面会し、日本の製造業の一翼を担う電子回路産業の取組みにご理解を賜り、国会会期中のご多忙のところ、ご来賓として当展示会レセプションにご臨席・ご祝辞を頂戴した。

### ●式次第：主催者挨拶

一般社団法人日本電子回路工業会	会長	小林 俊文
<b>乾杯挨拶</b>		
展示会運営委員会委員/JISSO PROTEC 2014 運営委員会	委員長	曾我 信之
<b>乾杯登壇者</b>		
世界電子回路業界団体協議会 (WECC)	事務総長	Rex Rozario
中国印刷電路行業協會 (CPCA)	理事長	由 鐘
香港線路板協會 (HKPCA)	専務理事	Thomas Li
米国電子回路協会 (IPC)	専務理事	John Mitchell
韓国電子回路産業協會 (KPCA)	会長	金 京熙
台湾電路板協會 (TPCA)	理事長	Rick Wu
一般社団法人日本電子回路工業会	会長	小林 俊文
一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長	小岩 一郎
一般社団法人日本ロボット工業会	副会長	藤田 宏昭
株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長	泉谷 涉
株式会社工業通信	代表取締役社長	井上 政基
一般社団法人日本電子回路工業会	副会長	山下 博樹
一般社団法人日本電子回路工業会	副会長	岩城 慶太郎
一般社団法人日本電子回路工業会	副会長	東入来 信博
一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長	横内 貴志男
一般社団法人日本ロボット工業会	副会長	河崎 勝浩
展示会運営委員会 / 展示会企画委員会	委員長	山本 治彦
展示会運営委員会	副委員長	曾谷 太
展示会運営委員会	副委員長	四津 三樹男
JISSO PROTEC 2014 運営委員会	委員長	曾我 信之
JISSO PROTEC 2014 実行委員会	委員長	武野 祐丸
JIEP 展示事業委員会	委員長	土門 孝彰
<b>第10回JPCA賞受賞者紹介</b>		
JPCA 賞選考委員会	委員長	越地 耕二
<b>第6回JPCAデザインアワード受賞者紹介</b>		
JPCAデザインアワード選考委員会	委員長	中島 安貴輝
<b>来賓挨拶</b>		
経済産業省	経済産業大臣	茂木 敏充
<b>2014 アカデミックプラザ賞受賞者紹介</b>		
アカデミックプラザWG	委員長	小岩 一郎
<b>第20回半導体・オブ・ザ・イヤール受賞者紹介</b>		
株式会社産業タイムズ社	取締役兼編集局長	津村 明宏
<b>中締め</b>		
一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長	小岩 一郎

(敬称略)



主催者挨拶 (JPCA 小林会長)



乾杯挨拶 (JISSO PROTEC 曾我運営委員長)



御来賓挨拶 (経済産業省 茂木経済産業大臣)



中締め挨拶 (JIEP 小岩副会長)

## 4

## 基調講演・パネルディスカッション

- 日 時：6月4日(水)～6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール 基調講演会場
- 特別協力：半導体産業新聞(株)産業タイムズ社)、一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)
- 聴 講 料：有料(VIP招待状持参者は聴講無料)
- 聴講者数：全6セッション 2,536名(前回実績全6セッション 2,237名)
- テー マ：日本をもっと!元気にする「自動車」「医療・ヘルスケア」「ビッグデータ」「ウェアラブル」

## 6月4日(水)

10:30～12:30

医療ヘルスケア



21世紀を開くナノカーボン：  
デバイスとバイオメディカルへの応用

篠原 久典  
名古屋大学 大学院理学研究科  
理学研究科長・理学部長



医療施設づくりにおける  
プロジェクトマネジメントの変革について

増田 順  
(株)セントラルユニ 代表取締役社長



日本の医療産業の現状と問題点  
—重粒子線がん治療装置開拓を行って—

嘉山 孝正  
山形大学 学長特別補佐 教授  
国立がん研究センター 名誉総長

14:00～15:00

3Dプリンタ



3Dプリンターの各方式と特徴

相馬 達也  
(一社)3Dデータを活用する会・3D-GAN 代表理事



3Dプリンタ活用事例のご紹介

水野 操  
(一社)3Dデータを活用する会・3D-GAN 理事

## 6月5日(木)

10:30～12:00

自動車



将来モビリティシステムの方向性

三田村 健  
日産自動車(株) 総合研究所  
モビリティ・サービス研究所 所長



エネルギー・シェールガス/省エネ半導体

燃料電池/水素エネルギー/再生可能新エ  
ネルギー/パワーデバイスの新時代

泉谷 渉  
(株)産業タイムズ社 代表取締役社長

14:00～15:30

パネルディスカッション デジカメ(4K/8K時代のデジカメ)

CIPAパネルディスカッション「デジタルカメラの動向」

コーディネータ：後藤 哲朗 展示会企画委員会 委員  
(株)ニコン フェロー&映像カンパニー 後藤研究室室長

座長：津村 明宏 半導体産業新聞 取締役兼編集局長

パネリスト：

山本 哲也 (株)ニコン 映像カンパニー 開発本部長  
平沢 方秀 キヤノン(株) ICP第四開発センター 所長  
山根 洋介 パナソニック(株) 技術総括担当 グループマネージャー  
代田 吉朗 (一社)カメラ映像機器工業会(CIPA) 業務委員会委員長  
オリンパス(株) 商品戦略本部 コンソーシアム担当部長



## 6月6日(金)

10:30～12:00

情報/通信



ビッグデータとIoT

川妻 庸男  
富士通(株) 執行役員常務 CTO&CIO



ウェアラブル/通信

インテリジェントグラスがもたらす  
新たな未来

荒川 賢一  
(株)NTTドコモ 先進技術研究所 所長

14:00～15:30

ウェアラブル/半導体



ウェアラブル機器の今後の進化に係る  
基板と半導体技術動向

平坂 和雄  
ブリズマーク・パートナーズ LLC  
シニア・コンサルタント



3Dプリンター技術と今後の展望

宇野 博  
(株)スリーディーシステムズジャパン  
3Dプリンター事業本部 事業本部長

※敬称略

# 5 第3回プリントエレクトロニクスコンベンション(PEC Japan)

- 日 時：6月4日(水)～6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホールPEC Japan 会場
- 聴 講 料：PEC Japan 2014 聴講券(3日間共通) 5,000円(税込)
- 聴講者数：650名(前回実績937名)

6月4日(水)	6月5日(木)	6月6日(金)
 	<b>10:30-13:00</b> <b>PE応用技術動向セッション</b> セッションリーダー：小田 正明 サブリーダー：前田 郷司、松本 博文	<b>10:30-13:00</b> <b>PEスクリーン印刷技術セッション</b> セッションリーダー：田中 稔彦 サブリーダー：佐野 康、宮里 桂太
	 <b>全印刷による有機TFTアレイフィルムの一貫製造ライン技術</b> 西 真一 次世代プリントエレクトロニクス技術研究組合 研究部	 <b>スクリーン印刷の先進技術レベルとPE製品化への課題解決手法</b> 佐野 康 (株)エスピーソリューション 代表取締役
 <b>PE用ポリエステルフィルム基板材料</b> 福垣 潤 東洋紡(株) 堅田フィルム技術センター	 <b>プリントエレクトロニクス技術への取り組み最新事例の紹介</b> 岩瀬 雅之 日本メクトロン(株) 技術本部/商品開発部 主事補	 <b>次世代のスクリーン印刷-スクリーンオフセット印刷-</b> 野村 健一 (独)産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター 研究員
<b>14:00-16:30</b> <b>同時通訳有 PECプレナリーセッション</b> セッションリーダー：菅沼 克昭 サブリーダー：松本 博文	<b>14:00-16:30</b> <b>これからのPE技術セッション</b> セッションリーダー：奥菌 博和 サブリーダー：内田 博、山上 剛	<b>14:00-16:30</b> <b>PE要素技術セッション</b> セッションリーダー：栗原 均 サブリーダー：永瀬 和郎
 <b>プリントエレクトロニクス応用LED照明デバイスの開発</b> Paul Deeben Senior Development Engineer Philips Lighting B.V.	 <b>プリントエレクトロニクスへ向けたカーボンナノチューブの応用</b> 橋本 剛 (株)名城ナノカーボン 代表取締役	 <b>スクリーン印刷による高精細印刷技術の開発</b> 森田 哲平 中沼アートスクリーン(株) 研究開発部 研究開発課
 <b>プリントエレクトロニクス国際標準化活動状況：協調協働機会の促進について</b> Marc Carter Director Technology Transfer IPC	 <b>プリント センサーシステム&amp;プリントNFC技術の開発</b> 勝本 浩司 シンフィルム エレクトロニクス ジャパン(株) VPセールス&ビジネス開拓日本	 <b>難燃VTM-0 PET、PENフィルムの開発とエレクトロニクス展開</b> 半田 昌史 帝人デュポンフィルム(株) 市場開発室
	 <b>プリントエレクトロニクスにおけるロールツーロールシステム</b> 島山 辰男 東レエンジニアリング(株) 開発部門 要素技術開発センター 首席技師	 <b>EPRIMA™：大気中硬化「銅ペースト」と低温硬化「絶縁樹脂」</b> 鳥元 正樹 旭硝子(株) 電子カンパニー 技術開発本部 開発企画部 マネージャー

※敬称略

# 6

# JIEP 最先端実装技術シンポジウム

●日 程：6月4日(水)～6日(金)  
 ●会 場：東京ビッグサイト 東3ホール特設ステージA・B会場  
 ●主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

●聴講料：有料  
 ●聴講者数：455名(前回実績584名)

## 6月4日(水)

A会場		B会場	
<b>4A1</b>   9:45-12:30 座長:西 眞一	<b>4A2</b>   13:35-16:20 座長:澤田 廉士	<b>4B1</b>   9:45-12:30 座長:天明 浩之	<b>4B2</b>   13:30-16:20 座長:金子 俊之
進展著しい3Dプリンター	日本の強みを活かしたメディカル機器開発	電磁解析技術ーサイドチャンネル攻撃に強いシステム設計手法ー	ワイドバンド通信機器のEMC対策
3Dプリンター、パーソナルモデルの可能性とものづくり 片岡 豪太 ビークル(株) 電子ビーム金属積層技術(金属3Dプリンター) 赤野 恒夫 (株)エイチ・ディー・エル 金属造形用3Dプリンターの最新動向 野口 信夫 キャノンマーケティングジャパン(株)	MEMS技術と生体活動モニタリングシステム 前中 一介 兵庫県立大学 3次元UVリソグラフィを用いたバイオデバイス開発 鈴木 孝明 香川大学 顧客目線での医療機器開発 吉田 博 ニプロ(株)	暗号モジュールに対するサイドチャンネル攻撃とその対策技術の研究動向 林 俊一 東北大学 ICチップレベルのサイドチャンネル情報漏洩の計測とシミュレーション 永田 真 神戸大学 回路シミュレーションに基づくサイドチャンネル攻撃に対する安全性予測法 五百旗頭 健吾 岡山大学	高速・広帯域通信時代の最新ノイズ測定技術 岡田 信孝 (株)TFF テクノロニクス社 携帯端末におけるインフラEMC評価法 前川 智哉 パナソニック(株) 電磁バンドギャップ(EBG)の原理とノイズ伝搬抑制への応用 豊田 啓孝 岡山大学

## 6月5日(木)

A会場		B会場	
<b>5A1</b>   9:45-12:30 座長:西田 秀行	<b>5A2</b>   13:35-16:20 座長:宝蔵寺 裕之	<b>5B1</b>   9:45-12:30 座長:土門 孝彰	<b>5B2</b>   13:35-16:20 座長:土門 孝彰
パワーモジュールの現状と課題 -SiからSiCへ-	センサー応用とロボット技術	環境問題とビジネスチャンス	先鋭的エレクトロニクスデバイスの研究動向
実装から見たSiCパワーデバイスの現状とこれから 宮代 文夫 よこはま高度実装技術コンソーシアム(YJC) パワーモジュールにおけるパッケージ・実装技術 池田 良成 富士電機(株) 高耐熱パワーモジュールパッケージング技術の課題 加柴 良裕 三菱電機(株)	拡大する非冷却遠赤外線センシング(カメラ)の市場展望および赤外線センシングの可能性 高澤 里美 (株)テクノ・システム・リサーチ 日産リーフ自動運転技術と将来社会システム 高木 潔 日産自動車(株) 次世代組立セルを支える知能化ロボット [MELFA Fシリーズ] 奥田 晴久 三菱電機(株)	戦略的都市鉱山研究拠点(SURE)の活動について 大木 達也 (独)産業技術総合研究所 SUREにおける開発技術・廃小型電気製品の自動ソーティング装置 古屋仲 茂樹 (独)産業技術総合研究所 鉄道システムにおけるエレクトロニクス機器の熱マネジメント技術 鈴木 敦 (株)日立製作所	光メタマテリアルとその加工技術 田中 拓男 (独)理化学研究所 ワイドギャップ窒化物半導体を用いた深紫外LED技術 平山 秀樹 (独)理化学研究所 静電噴霧堆積法を用いた積層型有機デバイスの開発 田島 右副 (独)理化学研究所

## 6月6日(金)

A会場		B会場	
<b>6A1</b>   9:45-12:30 座長:齊藤 雅之	<b>6A2</b>   13:35-16:20 座長:本多 進	<b>6B1</b>   9:45-12:30 座長:和嶋 元世	<b>6B2</b>   13:35-16:20 座長:猪川 幸司
最先端エレクトロメカシステム	2.5D・3D実装技術の進展と課題への挑戦	次世代モバイル機器対応基板技術	進化・多様化を支える部品内蔵技術の最新動向
MEMS・センサーにおける国際的な産業技術動向 三原 孝士 (一財)マイクロマシンセンター SMBG的使用可能な医療用高感度イムノアッセイチップの開発 高村 禎 北陸先端科学技術大学院大学 高齢化社会を豊かにするサービスロボット産業の将来展望 本田 幸夫 大阪工業大学	三次元半導体研究センター1200日の軌跡と今後の展開 友景 肇 福岡大学 先端3D実装技術の開発状況と今後の課題 青柳 昌宏 (独)産業技術総合研究所 TSVによる3D、2.5D実装技術の進展と課題 備田 精一 長野実装フォーラム	APX - 有機基板による2.5Dインターポザー 石田 光也 京セラSLCテクノロジー(株) ICパッケージ用高性能ビルドアップ絶縁材料 柴山 晃一 積水化学工業(株) TSVコア表面の有機薄膜RDL層にIPD素子を内蔵したインターポザー 福岡 義孝 (有)ウェイスティ	SI (Signal Integrity) からみた大いに期待する部品内蔵技術 碓井 有三 シグナルインテグリティコンサルタント モバイルデバイスに不可欠な部品内蔵基板技術の動向と課題 八甫 明彦 (株)東芝 部品内蔵プリント基板の技術課題とシミュレーション技術の適用 見山 克己 北海道科学大学

※敬称略

# 7

# ものづくりフェスタ2014



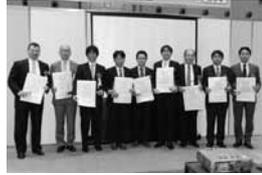
## 1) 半導体産業新聞主催「夢をカタチに」 次世代アプリ開発支援のセミナーと特別展示

●主 催：半導体産業新聞(株式会社産業タイムズ社)  
 ●日 時：6月4日(水)～6日(金)  
 ●会 場：東京ビッグサイト 東6ホール L会場  
 ●聴講料：無料  
 ●聴講者数：460名(前回実績：286名)

	6月4日(水)	6月5日(木)	6月6日(金)
	特別講演/IoT、M2Mが拓く近未来①	IoT、M2Mが拓く近未来②	最新の設計・開発・製造ソリューション
12:20～13:00			次世代電子機器設計プラットフォーム CR-8000/Design Forceのご紹介 (株)図研
13:10～13:50	【特別講演】サムスングループの現状と戦略 (株)産業タイムズ社	ARMのグローバル戦略 アーム(株)	小さなミックスシグナルIC「GreenPAK」による大きなメリット シレゴテクノロジージャパン(株)
14:00～14:40	「モバイルヘルスが創る未来」 ～からだだと社会を繋ぐ～ ドコモ・ヘルスケア(株)	IoT時代の無線マイコン 「TWE-Lite(トワイライト)」 東京コスモス電機(株)	複雑化する電子機器設計を支援するメンター・グラフィックス最新ソリューションXpeditionシリーズの概要 メンター・グラフィックス・ジャパン(株)
14:50～15:30	FLCOS～小型・高精細ディスプレイ～ シチズンファインテックミヨタ(株)	無線LANによるメッシュネットワークソリューション (株)村田製作所	プリント回路業界の最新トレンド (株)産業タイムズ社

## 2) 第20回半導体・オブ・ザ・イヤ-2014 受賞製品・技術発表

- 主 催：半導体産業新聞  
(株)産業タイムズ社)
- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
J会場
- 聴 講 料：無料
- 聴 講 者 数：65名(前回実績：60名)



### 受賞企業

#### 半導体・オブ・ザ・イヤ-2014 受賞一覧

##### 半導体デバイス部門

グランプリ	オムロン(株)	高低差50cm(分解能5mm)を検知できる絶対圧センサ
優秀賞	ローム(株)	MOSFETとIGBTの良特性を兼ね備えた新型トランジスタ「Hybrid MOS」
優秀賞	ザイリンクス(株)	業界初の20nmプロセスで製造したAll Programmable UltraScaleデバイス

##### 半導体製造装置部門

グランプリ	東京エレクトロン(株)	枚葉洗浄装置「CELLESTA™-iMD」
優秀賞	(株)ニコン	重ね合わせ精度と生産性を向上させたArF液浸スキャナー「NSR-S630D」
優秀賞	キヤノンアネルバ(株)	STT-MRAM 量産向けMTJ 多層膜成膜装置「NC7900」

##### 半導体用電子材料部門

グランプリ	昭和電工(株)	パワー半導体用SiCエピウエハー6インチ品
優秀賞	東レ・ダウコーニング(株)	車載エレクトロニクス用の高熱伝導性放熱接着剤
優秀賞	エア・ウォーター(株)	大面積8インチSiC on Si基板

## 3) ダントツ生産性向上パビリオンセミナー NEW

- 主 催：(一社)日本電子回路工業会
- 日 時：6月4日(水)~6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト  
東5ホール H会場
- 聴 講 料：無料
- 聴 講 者 数：600名



設計データフォーマットFUJIKOを用いた超高効率電子回路実装基板の製造効率向上の推進及び普及のための展示及びセミナーを実施。

### 6月4日(水)

松澤 浩彦	(株)図研 EDA事業部 シニア・パートナー
川瀬 英路、畑田 智子	ケイレックス・テクノロジー(株) プロジェクトマネージャ
大武 裕治	パナソニックファクトリーソリューションズ(株) 電子部品実装ディビジョン 印刷機開発部 部長
楠一弘	富士機械製造(株) ハイテック事業本部 企画部 リーダー
江南 俊夫	積水化学工業(株) 開発企画部 R&Dマネージャ
白波瀬 和孝	積水化学工業(株) IMプロジェクト グループ長
中村 篤	アルティメイトテクノロジー(株) CTO
西城 信吾	奥野製薬工業(株) 表面技術研究部 次長
山崎 浩	日置電機(株) 営業企画課 テクニカルマネージャ
野上 義生	東レエンジニアリング(株) 開発部門専門理事
松岡 宏志	(株)ワイ・ディ・シー EDS開発部 チーフエンジニア
友景 肇	NPO法人 半導体目利きボード(STM) 理事長

### 6月5日(木)

野北 寛太	(公財)福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター 副センター長
松岡 宏志	(株)ワイ・ディ・シー EDS開発部 チーフエンジニア
中尾 知	(株)フジクラ 新規事業推進センター
川瀬 英路、畑田 智子	ケイレックス・テクノロジー(株) プロジェクトマネージャ
大陽 恵子	大陽工業(株) プリント回路カンパニー 設計部 エキスパート
楠一弘	富士機械製造(株) ハイテック事業本部 企画部 リーダー
中山 啓	(株)オーケープリント 技術部 技術課 課長
松澤 浩彦	(株)図研 EDA事業部 シニア・パートナー
青木 仁	KOA(株) 技術センター セネラルマネージャ
山崎 浩	日置電機(株) 営業企画課 テクニカルマネージャ
友景 肇	NPO法人 半導体目利きボード(STM) 理事長

### 6月6日(金)

森下 順	(株)ウォルツ 代表取締役社長
加藤 義尚	福岡大学 半導体実装研究所 教授
服部 篤典	(株)野田スクリーン 課長
松岡 宏志	(株)ワイ・ディ・シー EDS開発部 チーフエンジニア
福岡 義憲	JEITA EDA技術専門委員会 LPB相互設計WG 主査(東芝)
川瀬 英路、畑田 智子	ケイレックス・テクノロジー(株) プロジェクトマネージャ
山崎 浩	日置電機(株) 営業企画課 テクニカルマネージャ
楠一弘	富士機械製造(株) ハイテック事業本部 企画部 リーダー
富田 教幸	富士プリント工業(株) 取締役 大阪営業所 所長
松澤 浩彦	(株)図研 EDA事業部 シニア・パートナー
友景 肇	NPO法人 半導体目利きボード(STM) 理事長

## 4) JMID主催 3D-MIDパイリオンセミナー NEW

- 主 催：日本MID協会(JMID)
- 日 時：6月4日(水)~6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト  
東6ホール M会場
- 聴 講 料：無料
- 聴 講 者 数：509名



MID技術の認知度UPに貢献し、市場拡大に寄与するとともに電子回路業界とのコラボレーションを実現するため、展示及びセミナーを実施。

### 6月4日(水)

MIDとは?技術的紹介、市場性、普及課題、JMID協会活動紹介  
日本MID協会(JMID)

#### パナソニックのMID技術

豊森 逸平 パナソニック(株) オートモーティブ & インダストリアルシステムス社  
制御機器事業部

#### SKWプロセスによる3D-MID

吉澤 徳夫 三共化成(株) 技術部 課長

#### レーザ表面改質と選択めっきを用いたMID工法

目黒 和幸 (地独) 若手県工業技術センター 機能表面技術部 主任専門研究員

### 6月5日(木)

MIDとは?技術的紹介、市場性、普及課題、JMID協会活動紹介  
日本MID協会(JMID)

アイデアを形に!! スリーディー・システムズ社製3Dプリンター最新情報  
(株)イグアス

### 6月6日(金)

MIDとは?技術的紹介、市場性、普及課題、JMID協会活動紹介  
日本MID協会(JMID)

#### MIDめっきの最新動向

レノラ・トスカノ  
日本マクダーミッド(株) マクダーミッド本社 OEM開発ディレクター

モジュール型汎用自動組立装置SmartFABによる3D-MID実装のご紹介  
濱根 剛 富士機械製造(株) FA開発部 設計課 シニアリーダー

#### LPKF-LDS工法の最新動向について

上館 寛之 LPKF Laser&Electronics(株) テクニカルサービスエンジニア

#### ハーティングの自動車市場向け3D-MID照明およびセンサー製品/アプリケーション

フランク ヴィットヴァー  
HARTING AG(スイス) Mitronics プロジェクト管理部門責任者

## 5) プラグフェストセミナー NEW

- 主 催：(一社)組込みシステム技術協会(JASA)
- 日 時：6月5日(木)
- 会 場：東京ビッグサイト東6ホール  
K会場
- 聴 講 料：無料
- 聴 講 者 数：115名



### MHL・コネクティビティを「統括」

ロプトピアス MHLコンソーシアム 社長

#### 日本プラグフェスト(入場者限定イベント)

同一インターフェース規格(MHL/HDMI)での他社製品との相互運用を確実なものにして、不具合解消や品質の向上を目的に実施。



※敬称略

## 6) プリント配線板ロードマップセミナー **NEW**

- 主 催：(一社)日本電子回路工業会
- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
日本プラグフェスト会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：65名
- 頒布価格：JPCA/JEITA会員2万円、  
非会員4万円(税込)



エレクトロニクス業界の明日を切り拓くプリント配線板の動向とプリント配線板業界が採るべき戦略の具体的な提案、減少傾向が続く国内プリント配線板製造業界の変革と生産拡大に向けた貴重な資料として皆様にご活用いただける内容にて開催。

## 7) 電子機器分解セミナー・展示

- 主 催：(一社)日本電子回路工業会
- 日 時：6月4日(水)～6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
特別展示ブース、K会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：388名(前回実績：908名)



- ◆スマホ・タブレットPCに見るハードウェアによる差別化終焉の日本の携帯電子機器を考える!
- ◆衝突防止システムの実装事例に見る、日本の高齢化社会ほど必要な自動車運転支援システムを考える!

上田 弘孝 セミコンサルト



スポンサー：

日本メクトロン、日本オルボテック、山下マテリアル、メルテックス、伊原電子工業、イーエスアイ、サトーセン、eSurface、深瀬商事、住友ベークライト

## 8) 実装体験コーナー

- 日 時：6月4日(水)～6月6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
実装体験コーナ会場
- 参 加 費：無料
- 参加者数：98名(前回実績：94名)



教育プログラムの一環として毎回好評のロボットキットを使って楽しくはんだ付け部品実装を学び、体験できるコーナを設置。

スポンサー：大日光・エンジニアリング

## 9) UL Forum (旧 UL IAG 会議) **NEW**

- 主 催：UL Japan
- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
日本プラグフェスト会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：54名



## 10) IPCAインド投資促進セミナー **NEW**

- 主 催：インド電子回路工業会 (IPCA)
- 日 時：6月5日(木)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
J会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：26名



JPCA 姉妹団体インドIPCAの協力により、インド政府電子情報技術政策局の方を招いて、投資優遇制度等のビジネス環境などインド市場の最新情報を解説。

## 11) EMS 最前線セミナー

～アジア・中国・日本の市場で売れる製品とモノづくり～

- 主 催：EMSONe
- 日 時：6月5日(木)～6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
J会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：253名(前回実績：252名)



6月5日(木)

セレスティカよりのトータル・ソリューションのご提供 - 最適化の追求  
小山 俊雄 セレスティカ・ジャパン KK Japan Sales & BD 部長

欧米系 EMS の強みとサンミナ-SCI

中村 公男  
㈱サンミナ-SCI システムズ・ジャパン 代ビジネスディベロプメント マネージャー

競争力のあるものづくりを追究・実践する富士通

松下 直久 富士通(株) テクノロジ&ものづくり本部 エグゼプロエンジニア

6月6日(金)

台湾の電子代工業界と Lite-On グループの取り組み

又川 鉄男 日本ライトン(株) 代表取締役社長 CEO

アップル・HPも注目 台頭する中国系 EMS と対抗する台湾系 EMS のアジア展開  
山田 泰司 EMS One Co., Ltd. 編集長

## 12) 産業技術総合研究所・特別展示

- 主 催：独立行政法人産業技術総合研究所 (AIST)
- 日 時：6月4日(水)～6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
特別展示ブース



ベッドサイズのフレキシブル圧力分布センサの開発

フレキシブルエレクトロニクス研究センター 印刷エレクトロニクスデバイスチーム

鉛フリー圧電材料

電子光技術研究部門 酸化物デバイスグループ

無機発光デバイス

電子光技術研究部門 酸化物デバイスグループ

光で液化・固化を繰り返す有機材料とそのプロセス応用

電子光技術研究部門 分子集積デバイスグループ

SATAポートに装着するだけでデータを守るセキュリティバリアデバイス

セキュアシステム研究部門 制御システムセキュリティ研究グループ

光エレクトロニクスプロジェクトについて

PETRA (技術研究組合光電子融合基盤技術研究所)

## 13) eSurface 特別セッション **NEW**

- 主 催：eSurface
- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト  
PEC Japan 会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：44名



eSurface 技術のご紹介

- 広がる機器設計とプリント配線板製造とアプリケーションへの応用 -

David Benson eSurface 代表取締役社長

eSurface 技術による低コスト生産、納期短縮及びフレキシブルな生産体制の構築、そして環境配慮型生産の実現。

eSurface 技術を用いたパラダイムシフトの具現化について講演を実施。

※敬称略

## 1) NPIプレゼンテーション (出展者新製品・技術紹介セミナー)

- 日 時：6月4日(水)～6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト  
東6ホールD会場  
東3ホールE会場
- 聴講料：無料
- 聴講者数：全9セッション51トピックス  
2,536名(前回実績：8セッション42トピックス1,342名)



- 発表出展会社 (50音順)
- アトテック ジャパン(株)/アトテックUSA(株)/アトテックエンジニアリング/アユミ工業(株)/  
荒川化学工業(株)/上村工業(株)/ウシオ電機(株)/オーク製作所/奥野製業工業(株)/  
ガーディアンジャパン(株)/カールツァイスマイクロスコピー(株)/化研テック(株)/  
Cloud Testing Service(株)/倉敷紡績(株)/コーヨーテクノロジー/山陽精工(株)/JCU/  
(株)島津製作所/ズース・マイクロテック(株)/千住金属工業(株)/ダイナトロン(株)/  
大日本スクリーン製造(株)/天竜精機(株)/東海神栄電子工業(株)/トーヨーケム(株)/(株)ニソール/  
ニッカン工業(株)/日本アビオニクス(株)/日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ(株)/  
日本オルボテック(株)/日本高純度化学(株)/日本シイエムケイ(株)/日本フィルコン(株)/  
日本マクダーミッド(株)/ノードソン(株)/ノバセントリック社/パナソニック(株)/(株)ビームセンス/  
日置電機(株)/日立化成(株)/(株)日立ハイテクサイエンス/(株)村田製作所/メルテックス(株)/  
メンター・グラフィックス・ジャパン(株)/ユニオンツール(株)/  
ローム・アンド・ハース電子材料(株)(ダウ・ケミカルグループ)

## 2) 第10回JPCA賞(アワード)

- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト ガレリアJPCAアワード 展示スペース

NPIプレゼンテーション発表参加者を対象とする、表彰制度「JPCA賞(アワード)」は、選考委員長東京理科大学越地教授、副委員長関東学院大学小岩教授他、有識者並びに新聞・雑誌編集者にて構成されるJPCA賞(アワード)選考委員会において、製品技術の独創性(独自性・オリジナリティ)産業界での発展性・将来性、信頼性、時世の適合性、表現形式について厳選なる審査の結果、応募テーマ22件の中から次の第10回JPCA賞アワード受賞者が決定し、6月4日にガレリアにて授賞式が行われた。



### プリント配線板技術展部門

- ノバポンドIT-次世代IC サブストレート向けノンエッチング密着増強プロセス  
アトテックジャパン株式会社
- シンボルマークにおける新プロセス『PIERD(ピアード)』  
東海神栄電子工業株式会社/株式会社ヤマトヤ商会
- 低誘電率・低誘電正接・高耐熱多層基板材料 MEGTRON7  
パナソニック株式会社
- セミアディティブ対応微細配線形成材料 AirFoil  
日立化成株式会社

### 半導体パッケージング・部品内蔵技術展部門

- 『スマートレントゲン』X線透視技術の新しい応用の探求 II  
株式会社ビームセンス

### 実装プロセステクノロジー展部門

- 変位検出によるソルダペーストの新しいぬれ性試験方法  
山陽精工株式会社

## 3) PROTECセミナー

- 主 催：(一社)日本ロボット工業会
- 日 時：6月4日(水)～6月6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト5ホール  
C会場
- 聴講料：無料
- 聴講者数：523名(前回実績：351名)



- 発表出展会社 (50音順)
- JUKIオートメーションシステムズ(株)/パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)/  
(株)日立ハイテクインスツルメンツ/富士機械製造(株)/マイクロニック・マイデータ・ジャパン(株)/  
武蔵エンジニアリング(株)/ヤマハ発動機(株)

## 4) ぷりんとはんじゅくセミナー

- 日 時：6月4日(水)～6月6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東2ホール  
F会場
- 聴講料：無料
- 聴講者数：496名(前回実績：552名)



プリント配線板の製造技術について基礎から学べる教育講座として定着した本イベントには新人教育の場として毎年多くの方が参加。

スポンサー：日本ケイデンス・デザイン・システムズ社

## 5) 光電子回路実装標準化セミナー

- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト 東4ホール  
G会場
- 聴講料：無料
- 聴講者数：150名(前回実績：246名)



委員長挨拶	東京大学 教授 中野 義昭
国際標準化の状況	栃木県産業技術センター所長 IEC/TC86/TC91/JWG9 Convenor 伊藤 日出男
リエゾン活動の状況	栃木県産業技術センター所長 IEC/TC86/TC91/JWG9 Convenor 伊藤 日出男
光インタフェースの標準化活動	三井化学(株) 塩田 剛史
北米におけるデータセンタ周辺 の光化状況(仮題)	US Conec Ltd. Chief Scientist 佐武 俊明

## 6) 電子回路基板ワークショップ **NEW**

- 日 時：6月4日(水)～6月6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール  
Iホール
- 聴講料：無料
- 聴講者数：685名



### 6月4日(水)

電子回路基板規格JPCA-UB01/  
高機能基板規格、各種試験方法、設計情報を新たに統合しちゃいました!  
友景 肇 福岡大学/浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会 幹事長

高稼働・高品質モノづくりを実現する印刷プロセスソリューション  
大武 裕治 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株) 電子部品実装ディビジョン 印刷機開発部 部長

### 6月5日(木)

電子回路基板規格JPCA-UB01/  
高機能基板規格、各種試験方法、設計情報を新たに統合しちゃいました!  
友景 肇 福岡大学/浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会 幹事長

部品内蔵基板「M-VIA Embedded」  
松本 徹 (株)メイコー 商品開発部 係長

高稼働・高品質モノづくりを実現する印刷プロセスソリューション  
大武 裕治 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株) 電子部品実装ディビジョン 印刷機開発部 部長

### 6月6日(金)

電子回路基板規格JPCA-UB01/  
高機能基板規格、各種試験方法、設計情報を新たに統合しちゃいました!  
友景 肇 福岡大学/浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会 幹事長

部品内蔵基板 SIMPACT  
富田 幸幸 富士プリント工業(株) 取締役 大阪営業所 所長

ウェアラブルを実現する分子接合技術による極薄FPC  
八甫谷 明彦 (株)東芝 セミコンダクター&ストレージ社 主査

高稼働・高品質モノづくりを実現する印刷プロセスソリューション  
大武 裕治 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株) 電子部品実装ディビジョン 印刷機開発部 部長

機能作り込みによる薄板部品内蔵基板  
山崎 勝美 (株)オーケープリント 技術部 部長

部品内蔵ポリイミド基板 WABE Package®  
中尾 知 (株)フジクラ 新規事業推進センター

## 7) WIRE Japan Showセミナー **NEW**

- 主 催：(株)工業通信
- 特別協力：難燃材料研究会
- 日 時：6月5日(木)
- 会 場：東京ビッグサイト 東4ホール G会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：107名



## 8) 電子回路プラザ

- 主 催：電子回路プラザ参加分科会・委員会、関西分科会、中部分科会、長野分科会、めっき委員会
- 会 場：東京ビッグサイト 東5ホール 電子回路プラザコーナ 東2ホール めっきプラザコーナ

JPCA 電子回路基板専門メーカーによる各地域分科会会員企業とめっき専門メーカーにより構成される「めっき委員会」から計21社が集結し、地域的優位性や電子回路の基礎から最先端にいたる技術開発、サポートータルサービスの特徴を紹介する「電子回路プラザ」を設置。また、出展者による各社製品・技術紹介セミナーとして恒例となったJPCAめっき委員会参加企業による多様化する表面処理技術の最新動向について発表が行われ、多数の聴講者が集まり好評を得た。



## 9) めっき表面処理セミナー

- 日 時：6月5日(木)～6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東2ホール F会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：712名(前回実績：268名)



6月5日(木)	
ダントツものづくり めっき驚きの事実・・・ (株)アズマ/栄電子工業(株)/ブラメックス(株)共同発表 小野 剛俊 (株)アズマ 取締役 品質保証部 部長	
基板材料の違いによるスルーホール銅めっきの評価 野崎 譲 ブラメックス(株) 技術部 課長	
パルス・ピアフィルめっきの技術 爾見 智三郎 (株)アズマ 営業部 係長	
6月6日(金)	
無電解NiPdAuめっきの紹介 石倉 克也 栄電子工業(株) 営業部	
無電解ニッケル/金めっきにおける未着及び異常析出への対応 池田 憲治 大日工業(株) 営業部/品質技術部 部長 丁子 真太郎 大日工業(株) 品質技術部 課長	
プリント配線基板上 無電解Ni/Auめっきとその前処理 永原 亮平 田代電化工業(株) 海外事業部	

## 10) アカデミックプラザ

- 日 時：6月4日(水)～6月6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東3ホール アカデミックプラザ講演会場
- 聴 講 料：無料
- 聴講者数：734名  
39トピックス(前回実績：872名 41トピックス)



- アカデミックプラザ参加大学・研究機関等一覧 (50音順)
- 宇都宮大学/大阪府立大学/神奈川工科大学/関東学院大学/九州大学/(地独)熊本県産業技術センター/群馬大学/神戸大学/国士舘大学/信州大学/スピンデバイステクノロジセンター/電子科学(株)/(株)デンソー/東京工業大学/東京大学/(地独)東京都立産業技術研究センター/東京理科大学/同志社大学/東北大学 三次元スーパーテックSLI 試作製造拠点/長野工業高等専門学校/日本大学/(株)日本表面処理研究所/(地独)北海道立総合研究機構/明治大学/明星大学/山口東京理科大学/龍谷大学/早稲田大学

## 11) アカデミックプラザ賞授賞式

- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト アカデミックプラザ講演会場

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、アカデミックプラザWG(小岩委員長:関東学院大学 理工学部理工学科 教授)で優秀な内容の論文が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定した。



### ●アカデミックプラザ受賞者

- 【AP9】「プリント配線板にかかわるめっき技術、技術、信頼性解析技術」  
宇都宮大学大学院工学研究科 学際先端システム学専攻 吉原 佐知雄
- 【AP12】「高速度カメラを用いたCuダイレクトレーザ加工時の発光量モニタリングと照射時間の設定」  
同志社大学 五百住 宗高、恩地 駿、廣垣 俊樹、青山 栄一  
龍谷大学 小川 圭二
- 【AP14】「TIMを評価するための新しい手法」  
神奈川工科大学大学院 電気電子工学専攻 小室 研究室  
斎藤 靖弘、鈴木 悟、小室 貴紀
- 【AP17】「物質界面の構造を映像化するサブサーフェスイメージング法の開発」  
神戸大学 大学院理学研究科 木村 建次郎、野本 和誠、小畑 恵子、鈴木 智子、美馬 勇輝  
京都大学 大学院工学研究科 大敷 範昭  
株式会社村田製作所 稲男 健  
Integral Geometry Instruments, LLC 木村 恵明

## 12) 第6回JPCAデザインアワード授賞式

- 日 時：6月4日(水)
- 会 場：東京ビッグサイト ガレリアJPCAデザインアワード展示スペース

美術系大学の先生並びに学生の皆さんにご協力頂き、応募頂いた作品の中から、中島委員長(日本大学大学院(芸術学部)教授)を始めとする7名の美術系大学教授と5展示会主催団体委員長・副委員長で構成されるJPCAデザインアワード選考委員会において審査の結果、次の作品が決定した。

- ◎授賞式を開催初日の午後にガレリア内特設会場にて実施。
- ◎ウェルカムレセプションにて受賞者登壇・紹介を実施。



↑グランプリ  
多摩美術大学大学院 美術研究科  
博士前期課程(グラフィックデザイン) 李与

### ●第6回JPCAデザインアワード受賞作品

- グランプリ**  
多摩美術大学大学院 美術研究科  
博士前期課程(グラフィックデザイン) 李与
- 準グランプリ**  
日本大学 芸術学部 下間 碧
- 優秀賞**  
日本大学 芸術学部 土屋 真子  
日本大学 芸術学部 金 志原
- 奨励賞**  
日本大学 芸術学部 出水 友美子  
多摩美術大学大学院 美術研究科  
博士前期課程(グラフィックデザイン) 河 瑞妍  
多摩美術大学大学院 美術研究科  
博士後期課程 柏 大輔

## 13) IPC はんだ付けコンテスト

- 主 催：米国電子回路協会(IPC)
- 日 時：6月4日(水)～6月6日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東6ホール IPC はんだ付けコンテスト会場
- 参加費：無料
- 参加者数：55名(前回実績：28名)



JPCA 姉妹団体米国IPCが主催するはんだ付けコンテスト。会場では、自動車メーカーの出場者をはじめ、数多くの技術者の様子を熱心に見物する人が多く見られた。優勝者には2015年米国にて開催される世界大会への出場権が与えられた。

## 9 電子回路営業士・資格フォローアップセミナー



- 日 時：6月4日(水)～6日(金)
- 会 場：東3商談室
- 資格更新料：会員企業2,000円／非会員企業4,000円(税込)

必修セミナー	6月4日(水)・5日(木) 13:00～15:00	電子回路業界における瑕疵担保責任と下請法について ～不良完成品を巡るトラブルへの対処～
共通セミナー	6月4日(水)～6日(金)	・基調講演 ・ぶりんとぼんじゅくセミナー ・電子機器分解セミナー ・EMSONeセミナー ・光電子回路実装標準化セミナー

## 10 併催JPCA公式国際会議

- 6月3日(火)

D66 Subcommittee WG Meeting  
JPCAプリントエレクトロニクス基板規格部会／IPC-D60委員会合同会議  
WECC Standard Meeting (WECC標準化委員会)

- 6月4日(水)

日中電子回路友好促進協議会  
理事会(第30回)



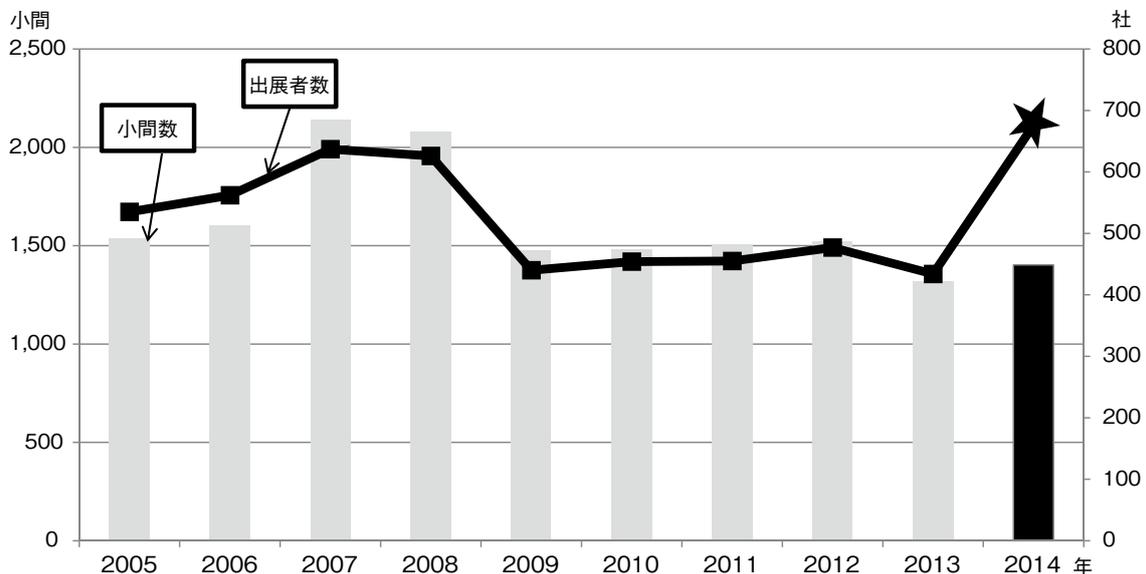
## 11 展示規模

### 1) 過去10年の開催規模実績(2005年～2014年)

※2005年からマイクロエレクトロニクスショー、2007年からJISSO PROTEC、2008年からのつくりフェスタ、2010年からラージエレクトロニクスショー、  
2014年からWIRE Japan Show 同時開催

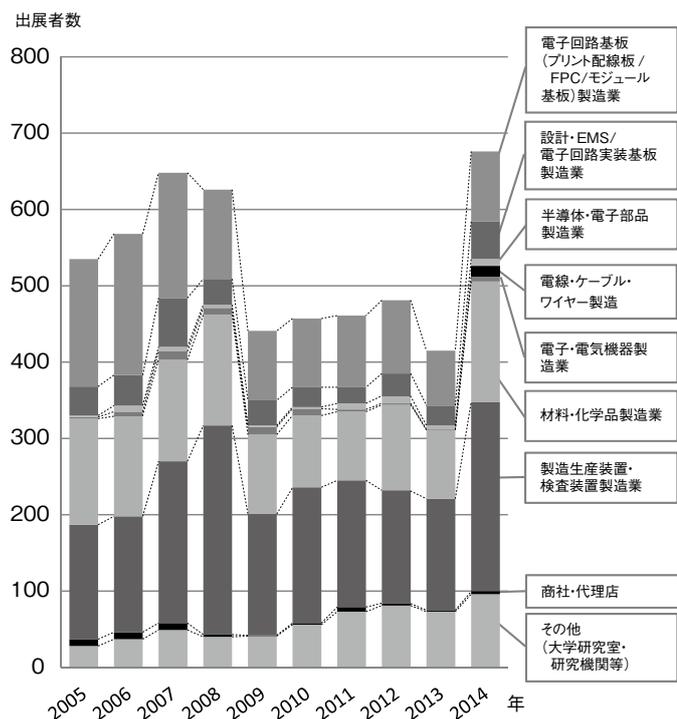
年 度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
小 間 数	1,539	1,601	2,143	2,078	1,475	1,483	1,508	1,522	1,320	<b>1,402</b>
出 展 者 数	535	562	637	626	440	454	455	477	434	<b>676</b>
開 催 会 場	有明*									

\*有明：東京ビッグサイト

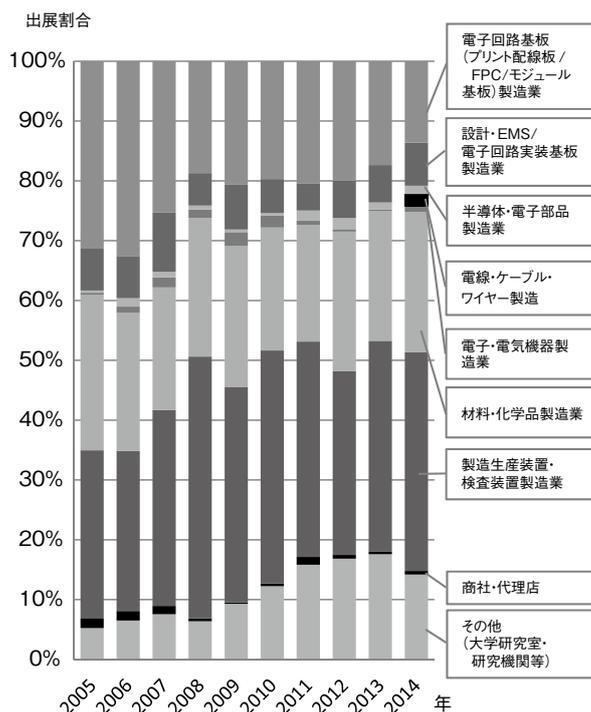


## 2) 過去10年の業種別出展者数の推移

### ①業種別出展者数推移



### ②業種別出展者割合の推移



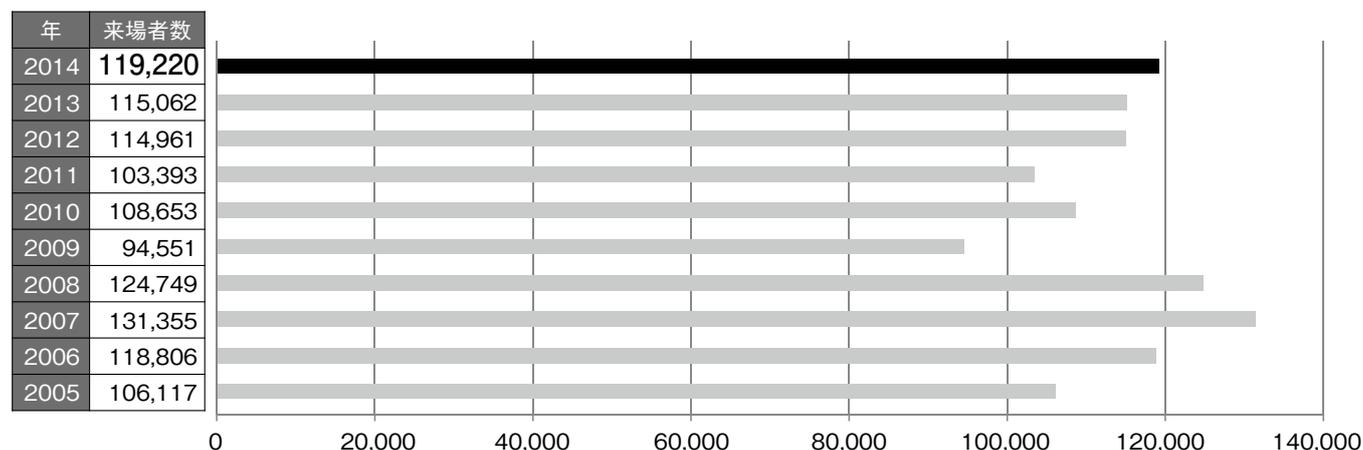
## 3) 来場者分析

①総来場者数：119,220名（6月4日（水）～6日（金）の3日間の累計：前年比3.6%増）

（ ）内、左数値は2013年、右数値は2012年実績

区分	天候	来場者数	実登録者数
6月4日(水)	初日 晴	36,466名 (32,450名・31,996名)	12,945名 (10,625名・10,478名)
6月5日(木)	2日目 雨	39,361名 (39,271名・37,601名)	11,829名 (11,828名・11,289名)
6月6日(金)	最終日 雨	43,393名 (43,341名・45,364名)	12,274名 (12,263名・12,838名)
合計		119,220名 (115,062名・114,961名)	37,048名 (34,716名・34,605名)

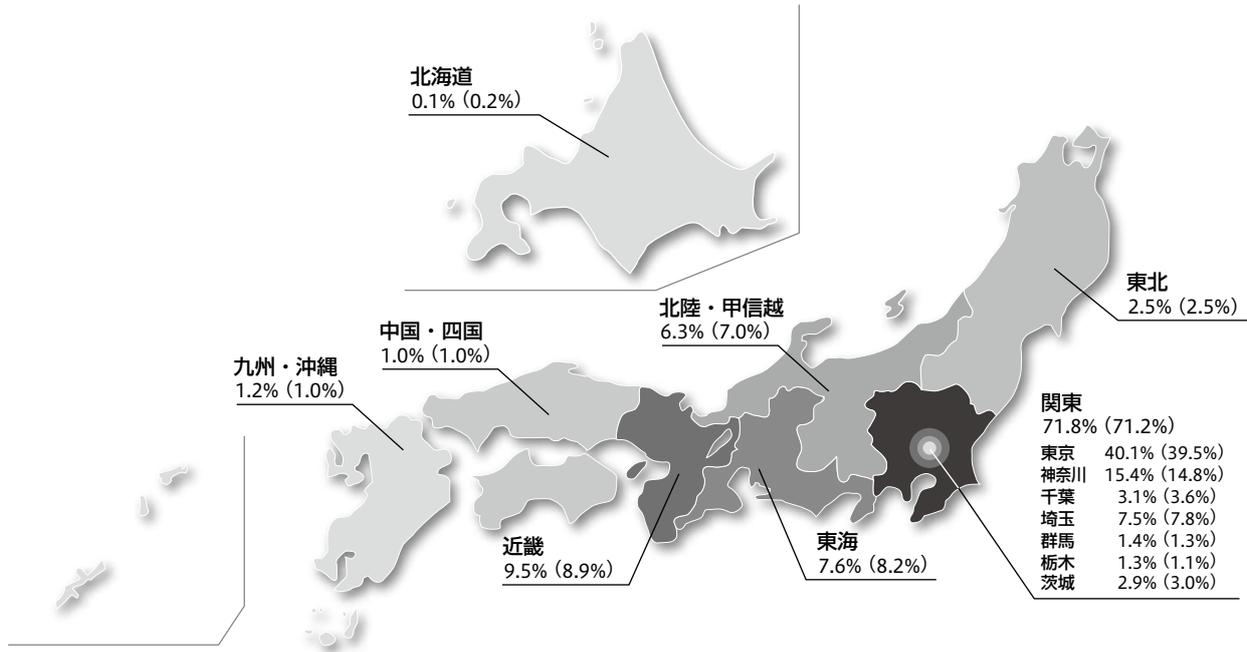
### ②過去10年の来場動員実績（2005年～2014年）



### ③国内来場者地域割合

( )内は前年度実績

例年同様、関東からの来場者が全体の7割(2014年：71.8%、2013年：71.2%)を占めており、若干名、近畿地方からの来場者が増えたが、国内来場者の地域割合数はほぼ昨年と同様の傾向であった。



### ④海外実登録者内訳

海外実登録者数：2,810名実登録者全体の7.5% (2013年実績：2,879名実登録者全体の8.3%)

( )前回数値

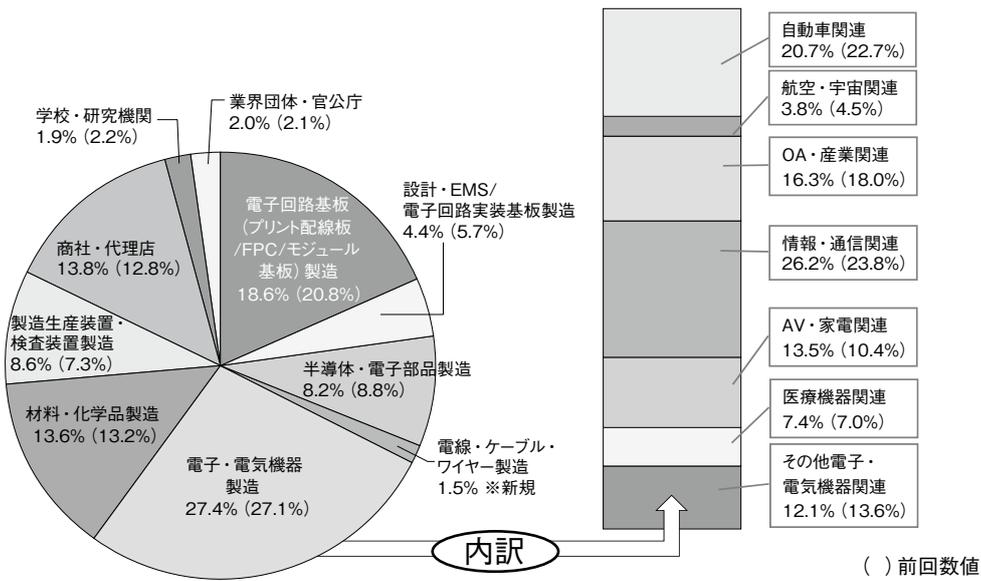
◆アジア圏	韓国:39.0% (45.1%) 台湾:24.7% (22.1%) 中国:22.6% (17.7%) タイ:1.5% (2.5%) シンガポール:1.4% (1.3%) マレーシア:1.1% (0.9%) ベトナム:0.3% (0.5%) フィリピン:0.3% (0.5%) ロシア:0.2% (0.4%) インド:0.3% (0.2%) モンゴル:0.1% (—) ミャンマー:0.1% (—) マカオ:0.1% (—)
◆アメリカ圏	アメリカ:2.8% (3.7%) カナダ:1.3% (0.3%) ブラジル:0.4% (—)
◆ヨーロッパ圏	ドイツ:0.6% (0.5%) オーストリア:0.5% (0.3%) イギリス:1.6% (0.3%) スコットランド:0.2% (—) ルーマニア:0.1% (—) マケドニア共和国:0.2% (—) イタリア:0.2% (—) ルクセンブルク:0.1% (—) ポルトガル:0.1% (—) オランダ:0.1% (—)
◆アフリカ圏	スワジランド:0.1% (—)

### ⑤来場者の業種分類

業種	2014年	2013年	増加人数	昨年比
●電子回路基板(プリント配線板/FPC/モジュール基板)製造	6,894	7,159	-265名	-3.7%
●設計・EMS/電子回路実装基板製造	1,622	1,976	-354名	-17.9%
●半導体・電子部品製造	3,016	3,025	-9名	-0.3%
●電線・ケーブル・ワイヤー製造	535	—	535名	—
●電子・電気機器製造	10,129	9,348	781名	+8.3%
内訳				
自動車関連	2,097	2,123	-26名	-1.2%
航空・宇宙関連	384	418	-34名	-8.1%
OA・産業関連	1,647	1,683	-36名	-2.1%
情報・通信関連	2,656	2,223	433名	+19.4%
AV・家電関連	1,362	975	387名	+39.6%
医療機器関連	754	651	103名	+15.8%
その他電子・電気機器製造	1,229	1,275	-46名	-3.6%
●材料・化学品製造	4,989	4,547	442名	+9.7%
●製造生産装置・検査装置製造	3,149	2,508	641名	+25.5%
●商社・代理店	5,062	4,397	665名	+15.1%
●学校・研究機関	691	745	-54名	-7.2%
●業界団体・官公庁	723	739	-16名	-2.1%
●報道関係者	238	272	-34名	-12.5%
●実登録者合計	37,048	34,716	2,332名	+6.7%
(内) 海外	2,810	2,879	-69名	-2.3%
(内) VIP来場実登録者数	8,444	8,955	-511名	-5.7%

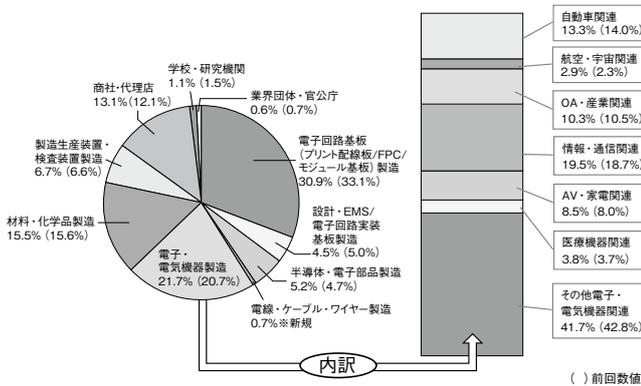
⑥業種別来場者分類グラフ

全展示会実績



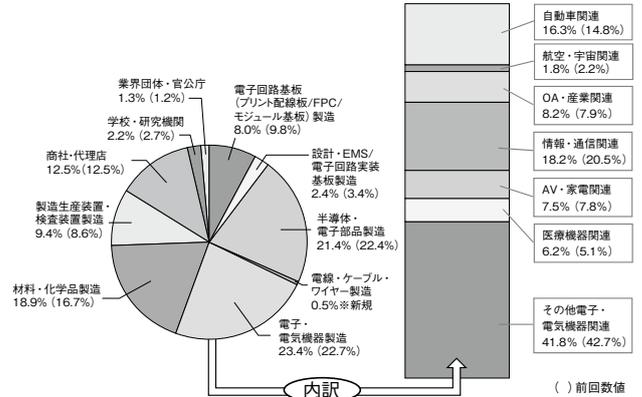
JPCA Show 2014

2014 プリント配線板技術展



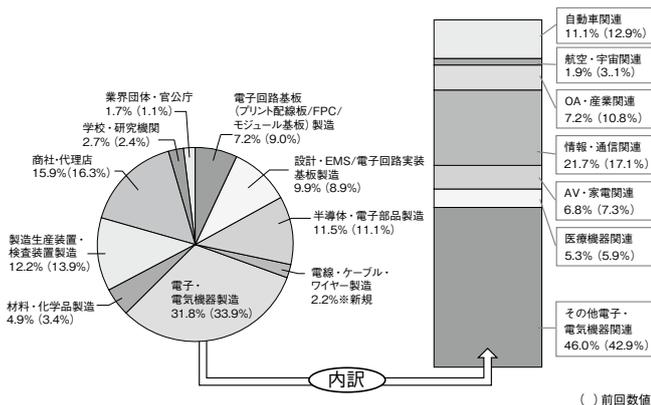
JPCA Show 2014

2014 半導体パッケージング・部品内蔵技術展



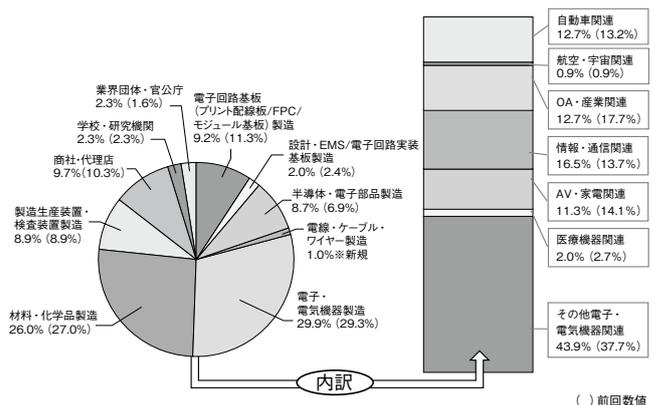
JPCA Show 2014

2014 機器半導体・受託生産システム展



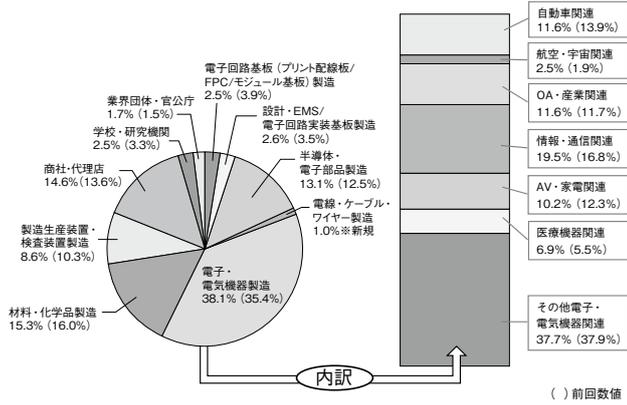
ラージエレクトロニクスショー2014

2014 プリントドエレクトロニクス最適生産システム展



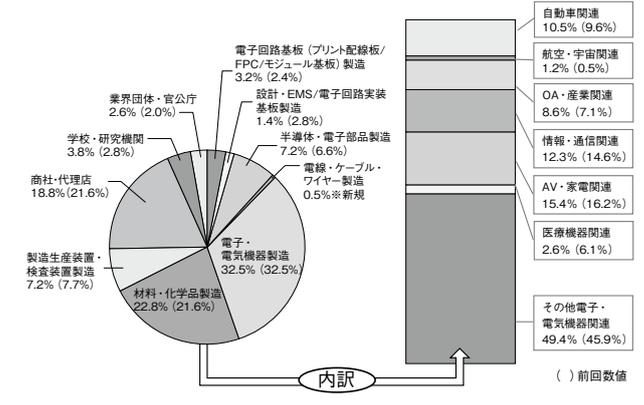
# ラージエレクトロニクスショー2014

## 2014 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展

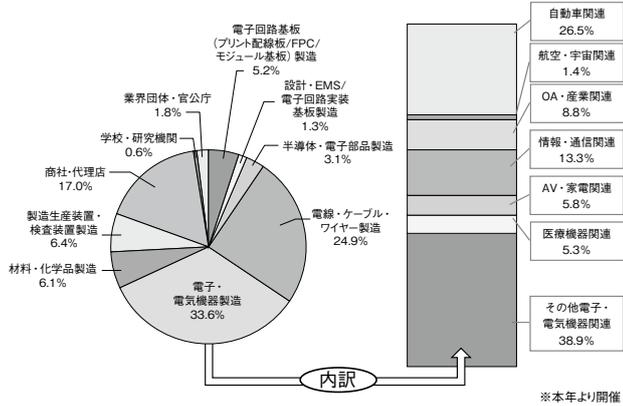


# ラージエレクトロニクスショー2014

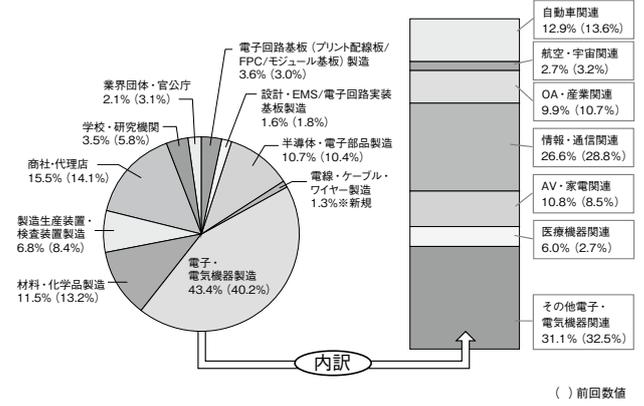
## 2014 LED/OLED 応用技術展



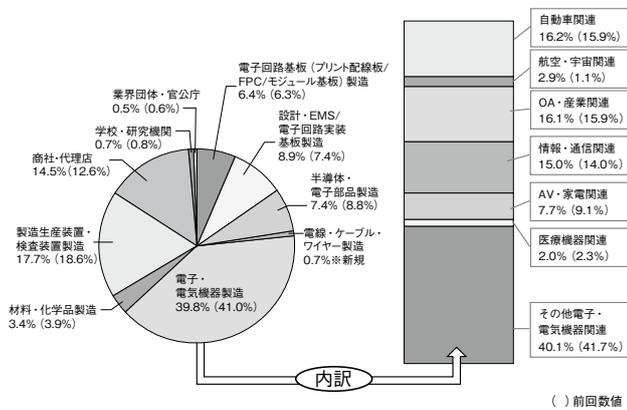
# WIRE Japan Show 2014



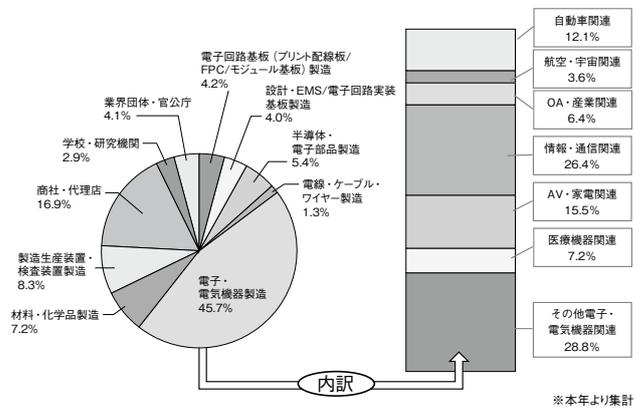
# 2014 マイクロエレクトロニクスショー



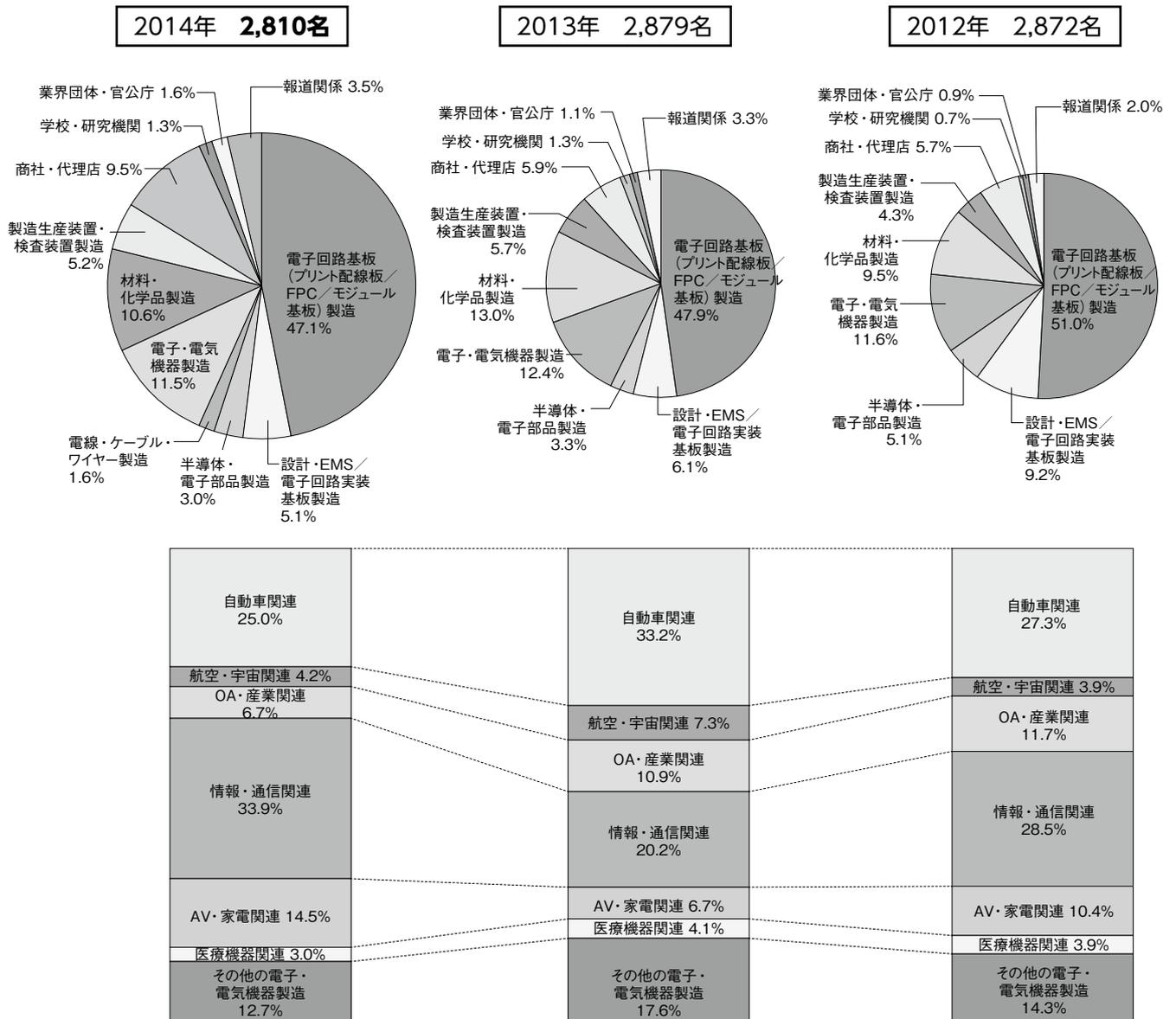
# JISSO PROTEC 2014



# ものづくりフェスタ2014

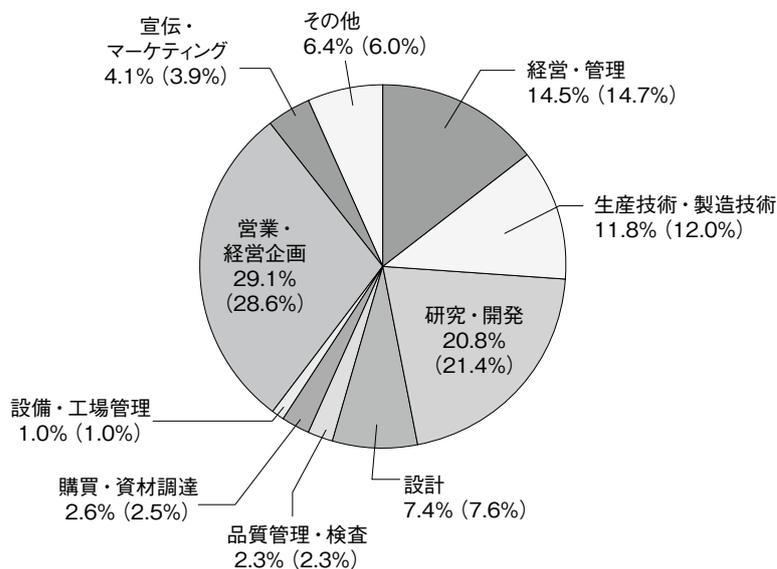


⑦過去3年の海外来場者業種推移



⑧来場者の職種分類

( ) 前回数値



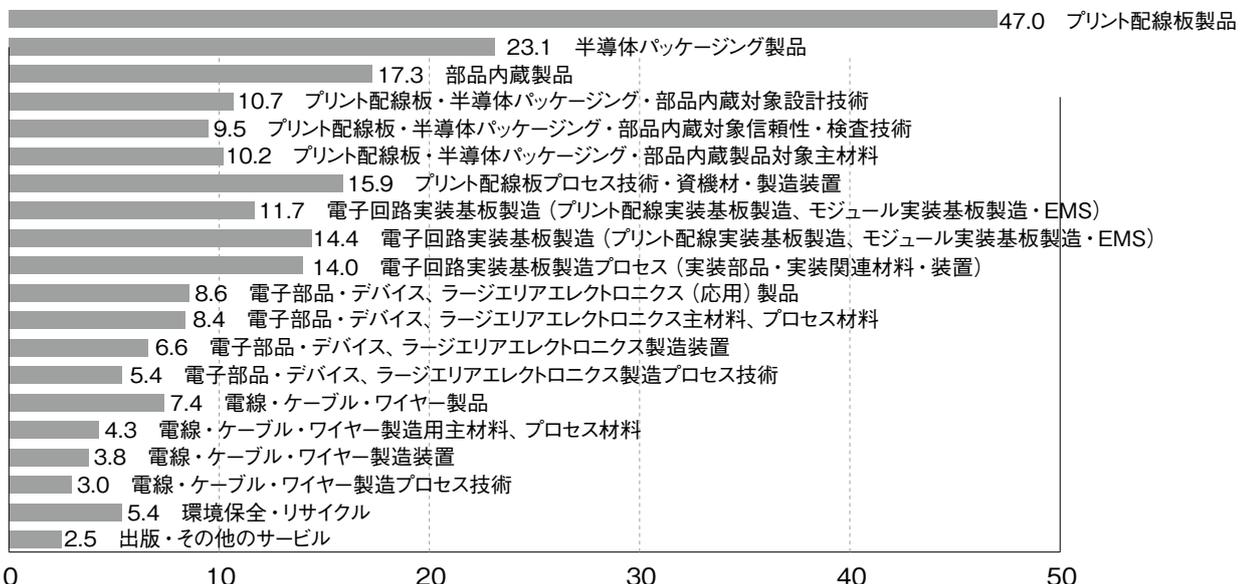
⑨来場者の業種別職種別分類

前回実績

業種	職種	経営管理	生産技術・製造技術	研究開発	設計	品質管理・検査	購買 資材調達	設備 工場管理	営業 経営企画	宣伝 マーケティング	その他
電子回路基板(プリント配線板/FPC/モジュール基板)製造	職 種	21.9%	23.0%	15.8%	5.0%	3.9%	3.5%	1.9%	19.3%	2.0%	3.7%
	業 種	20.2%	23.6%	16.4%	6.2%	4.1%	2.7%	1.9%	19.7%	1.6%	3.6%
設計・EMS/ 電子回路実装基板製造	職 種	19.0%	20.5%	10.5%	20.9%	2.9%	2.5%	2.2%	17.0%	2.0%	2.5%
	業 種	20.5%	15.7%	12.4%	22.5%	3.1%	2.2%	1.9%	17.5%	1.9%	2.3%
電線・ケーブル・ワイヤー製造	職 種	15.4%	15.7%	16.6%	9.7%	4.1%	0.6%	2.2%	29.4%	4.1%	2.2%
	業 種	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
半導体・電子部品製造	職 種	9.7%	15.9%	31.7%	8.1%	2.7%	3.0%	0.7%	19.1%	6.1%	3.0%
	業 種	10.8%	15.1%	32.7%	7.0%	2.1%	3.0%	0.6%	19.5%	6.0%	3.2%
電子・電気機器製造	職 種	11.5%	15.1%	26.0%	13.6%	2.7%	4.4%	1.0%	18.2%	3.5%	4.0%
	業 種	11.7%	15.5%	26.0%	12.9%	2.8%	4.5%	1.3%	18.4%	3.2%	3.7%
自動車関連	職 種	11.0%	22.2%	30.6%	11.8%	2.1%	4.8%	1.4%	10.9%	2.6%	2.6%
	業 種	12.3%	21.4%	32.1%	11.2%	2.0%	4.2%	1.8%	10.8%	1.8%	2.4%
航空・宇宙関連	職 種	14.7%	26.3%	16.7%	12.8%	6.4%	3.8%	1.4%	11.5%	1.3%	5.1%
	業 種	13.3%	23.4%	18.4%	15.0%	3.3%	5.8%	2.5%	10.0%	2.5%	5.8%
OA・産業関連	職 種	9.9%	17.5%	24.9%	15.7%	3.7%	6.0%	1.1%	15.1%	4.0%	2.1%
	業 種	9.4%	16.4%	23.3%	18.5%	3.8%	4.3%	1.5%	16.3%	3.0%	3.5%
情報・通信関連	職 種	12.7%	13.2%	28.8%	14.3%	2.8%	4.3%	0.9%	15.4%	3.7%	3.9%
	業 種	10.4%	13.8%	31.9%	11.6%	2.7%	5.8%	1.1%	14.8%	3.9%	4.0%
AV・家電関連	職 種	7.0%	16.1%	31.2%	21.7%	2.9%	4.9%	0.6%	10.6%	2.3%	2.7%
	業 種	7.6%	20.2%	27.1%	16.9%	2.9%	6.9%	1.8%	10.4%	3.3%	2.9%
医療機器関連	職 種	13.5%	13.9%	33.5%	10.5%	0.4%	6.0%	1.9%	15.0%	1.9%	3.4%
	業 種	13.7%	12.8%	37.2%	9.8%	0.9%	3.1%	1.3%	15.9%	0.9%	4.4%
その他の電子・電気機器製造	職 種	12.1%	12.2%	21.7%	11.8%	2.6%	3.7%	0.9%	25.5%	4.2%	5.3%
	業 種	13.4%	12.9%	20.7%	11.8%	2.9%	3.7%	1.0%	25.7%	3.7%	4.2%
材料・化学品製造	職 種	10.4%	4.0%	39.2%	0.4%	1.3%	1.1%	0.5%	35.1%	5.7%	2.3%
	業 種	10.6%	4.7%	39.6%	0.4%	1.5%	0.9%	0.3%	34.4%	5.6%	2.0%
製造生産装置・検査装置製造	職 種	17.3%	11.1%	19.0%	14.9%	1.7%	1.3%	0.9%	26.8%	4.1%	2.9%
	業 種	16.8%	10.0%	19.5%	16.9%	1.7%	1.8%	0.8%	24.7%	4.8%	3.0%
商社・代理店	職 種	15.7%	0.7%	1.4%	0.5%	1.2%	1.6%	0.3%	71.7%	4.2%	2.7%
	業 種	16.5%	0.9%	1.6%	0.5%	0.9%	1.6%	0.3%	71.3%	4.3%	2.1%
学校・研究機関	職 種	3.7%	0.6%	47.1%	1.4%	0.9%	0.6%	0.6%	4.0%	2.3%	38.8%
	業 種	4.7%	1.3%	43.3%	0.4%	0.2%	0.4%	0.2%	3.1%	2.4%	44.0%
業界団体・官公庁	職 種	16.3%	2.4%	15.1%	0.4%	1.6%	0.0%	0.8%	17.8%	9.9%	35.7%
	業 種	12.3%	1.3%	19.2%	1.3%	1.3%	0.0%	0.4%	18.7%	11.5%	34.0%
来場者全体	職 種	14.5%	11.8%	20.8%	7.4%	2.3%	2.6%	1.0%	29.1%	4.1%	6.4%
	業 種	14.7%	12.0%	21.4%	7.6%	2.3%	2.5%	1.0%	28.6%	3.9%	6.0%

⑩来場者が関心のある製品分類

複数回答のため、指数(ポイント)表示



⑪業種別来場者の関心のある製品(展示)分野

複数回答のため、指数(ポイント)表示

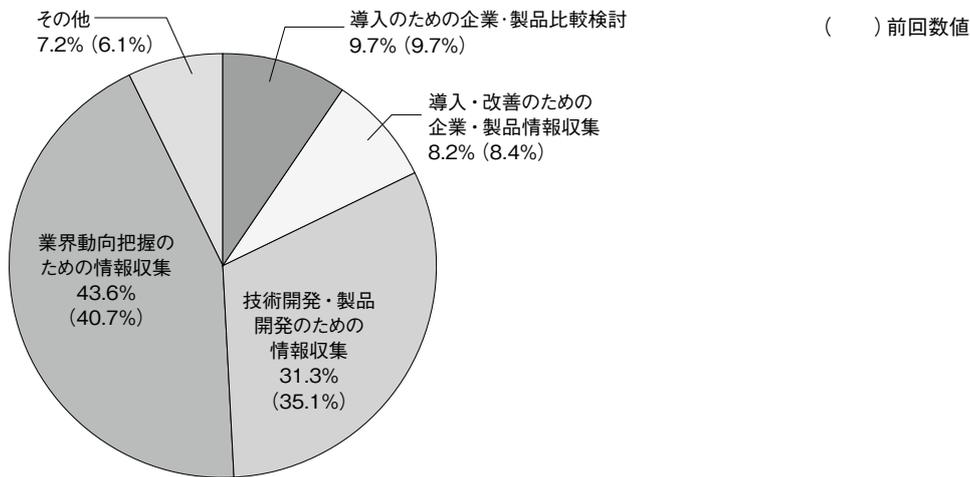
業種	関心分野	製品(展示)分野																					
		プリント配線板製品	半導体パッケージング製品	部品内蔵製品	部品内蔵対象設計技術	プリント配線板・半導体パッケージング・部品内蔵対象信頼性・検査技術	プリント配線板・半導体パッケージング・部品内蔵対象主材料	プリント配線板・半導体パッケージング・製造装置	プリント配線板プロセス技術・資機材・製造装置	半導体パッケージング・部品内蔵プロセス技術・資機材・製造装置	半導体パッケージング・部品内蔵プロセス技術・資機材・製造装置	電子回路実装基板製造(プリント配線実装基板製造・モジュール実装基板製造・EMS)	電子回路実装基板製造(実装部品・実装関連材料・装置)	電子回路実装基板製造プロセス(実装部品・実装関連材料・装置)	ラジエレクトロニクス(プリントドエレクタロニクス) 応用製品	ラジエレクトロニクス(プリントドエレクタロニクス) 主材料・プロセス材料	ラジエレクトロニクス(プリントドエレクタロニクス) 製造装置	MEMS/デバイス(製造プロセス技術)	ラジエレクトロニクス(部品・MEMS/デバイス)製造プロセス技術	電線・ケーブル・ワイヤー製品	電線・ケーブル・ワイヤー製造用主材料・プロセス材料	電線・ケーブル・ワイヤー製品装置	電線・ケーブル・ワイヤー製品プロセス技術
電子回路基板(プリント配線板/FPC/モジュール基板)製造		12.5	2.7	2.4	2.0	1.8	1.7	3.5	0.9	1.8	1.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1		
設計・EMS/電子回路実装基板製造		1.9	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	1.1	0.9	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		
半導体・電子部品製造		2.4	3.0	2.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.5	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		
電線・ケーブル・ワイヤー製造		0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.8	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0		
電子・電気機器製造		10.0	4.4	4.8	2.7	2.3	1.5	3.1	2.5	4.5	4.5	2.9	1.5	1.7	1.4	2.7	0.8	1.0	0.8	1.1	0.5		
自動車関連		1.3	0.6	0.8	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0		
航空・宇宙関連		0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
OA・産業関連		1.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		
情報・通信関連		2.0	0.8	1.1	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.9	0.9	0.6	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2		
AV・家電関連		1.0	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		
医療機器関連		0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		
その他の電子・電気機器製造		3.9	1.8	1.6	1.0	0.9	0.5	1.3	1.1	1.8	1.7	1.1	0.6	0.8	0.5	1.0	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2		
材料・化学品製造		6.4	4.2	2.2	1.2	0.8	2.9	1.7	1.5	1.1	1.5	1.0	2.7	0.6	0.8	0.3	0.7	0.2	0.2	0.6	0.1		
製造生産装置・検査装置製造		2.6	1.9	1.1	0.6	0.8	0.5	1.9	1.6	1.2	1.5	0.4	0.4	1.0	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1		
商社・代理店		5.5	2.8	1.7	1.0	1.0	1.2	1.8	1.5	1.7	1.6	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.8	0.3		
学校・研究機関		0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1		
業界団体・官公庁		0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1		
全体		42.1	20.3	15.3	9.4	8.4	9.2	14.0	10.1	12.7	12.5	7.4	7.4	5.7	4.7	5.8	3.3	2.7	2.1	3.9	1.4		

⑫職種別来場者の関心のある製品

複数回答のため、指数(ポイント)表示

業種	関心分野	製品(展示)分野																					
		プリント配線板製品	半導体パッケージング製品	部品内蔵製品	部品内蔵対象設計技術	プリント配線板・半導体パッケージング・部品内蔵対象信頼性・検査技術	プリント配線板・半導体パッケージング・部品内蔵対象主材料	プリント配線板・半導体パッケージング・製造装置	プリント配線板プロセス技術・資機材・製造装置	半導体パッケージング・部品内蔵プロセス技術・資機材・製造装置	半導体パッケージング・部品内蔵プロセス技術・資機材・製造装置	電子回路実装基板製造(プリント配線実装基板製造・モジュール実装基板製造・EMS)	電子回路実装基板製造(実装部品・実装関連材料・装置)	電子回路実装基板製造プロセス(実装部品・実装関連材料・装置)	ラジエレクトロニクス(プリントドエレクタロニクス) 応用製品	ラジエレクトロニクス(プリントドエレクタロニクス) 主材料・プロセス材料	ラジエレクトロニクス(プリントドエレクタロニクス) 製造装置	MEMS/デバイス(製造プロセス技術)	ラジエレクトロニクス(部品・MEMS/デバイス)製造プロセス技術	電線・ケーブル・ワイヤー製品	電線・ケーブル・ワイヤー製造用主材料・プロセス材料	電線・ケーブル・ワイヤー製品装置	電線・ケーブル・ワイヤー製品プロセス技術
経営・管理		7.1	3.0	2.1	1.5	1.3	1.1	2.3	1.5	1.9	1.6	1.0	0.8	0.8	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	1.0	0.3		
生産技術・製造技術		5.5	1.6	1.6	1.0	1.2	0.9	2.6	1.0	2.0	2.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1		
研究・開発		9.6	6.1	4.6	2.7	2.3	3.2	3.3	3.0	2.8	2.9	2.8	3.3	1.6	1.8	1.4	0.9	0.5	0.5	1.0	0.3		
設計		4.0	1.4	1.5	1.3	0.7	0.5	1.0	0.7	1.4	1.1	0.6	0.3	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1		
品質管理・検査		1.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		
購買・資材調達		1.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		
設備・工場管理		0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		
営業・経営企画		12.9	7.2	4.6	2.5	2.2	2.8	4.0	3.5	3.9	3.7	2.2	2.3	2.1	1.3	2.2	1.5	1.4	0.9	1.5	0.7		
宣伝・マーケティング		1.4	1.2	0.8	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2		
その他		2.5	1.3	1.0	0.6	0.5	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.7	0.6		

### ⑬ 来場の目的



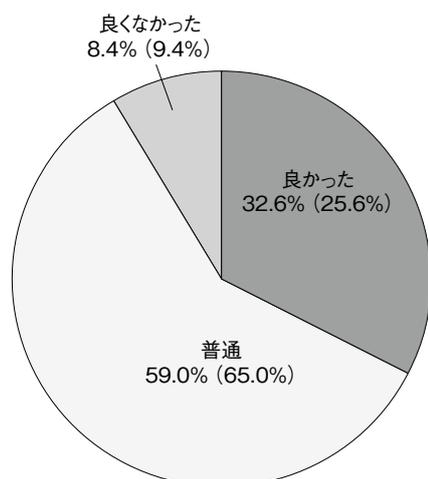
### ⑭ 業種別来場の目的

業種	来場目的	導入のための企業・製品比較検討	導入・改善のための企業・製品情報収集	技術開発・製品開発のための情報収集	業界動向把握のための情報収集	その他
電子回路基板(プリント配線板/FPC/モジュール基板)製造		23.4%	14.1%	25.6%	29.8%	7.1%
設計・EMS/電子回路実装基板製造		14.8%	18.1%	31.0%	31.6%	4.5%
半導体・電子部品製造		10.8%	9.2%	38.8%	35.3%	5.9%
電線・ケーブル・ワイヤー製造		6.4%	4.3%	12.8%	69.2%	7.3%
電子・電気機器製造		13.5%	9.5%	43.6%	29.2%	4.2%
自動車関連		16.7%	21.2%	28.2%	30.1%	3.8%
航空・宇宙関連		10.0%	11.6%	34.7%	40.7%	3.0%
OA・産業関連		8.0%	8.3%	39.3%	41.0%	3.4%
情報・通信関連		8.3%	10.3%	40.8%	33.0%	7.6%
AV・家電関連		11.4%	12.0%	43.2%	27.4%	6.0%
医療機器関連		6.9%	8.7%	34.4%	43.6%	6.4%
その他の電子・電気機器製造		3.5%	3.5%	46.1%	43.6%	3.3%
材料・化学品製造		4.8%	5.5%	39.3%	46.1%	4.3%
製造生産装置・検査装置製造		6.0%	18.2%	36.6%	35.4%	3.8%
商社・代理店		3.1%	2.6%	40.7%	38.5%	15.1%
学校・研究機関		3.6%	4.4%	14.7%	67.0%	10.3%
業界団体・官公庁		3.5%	3.2%	18.6%	55.5%	19.2%
全体		9.7%	8.2%	31.3%	43.6%	7.2%

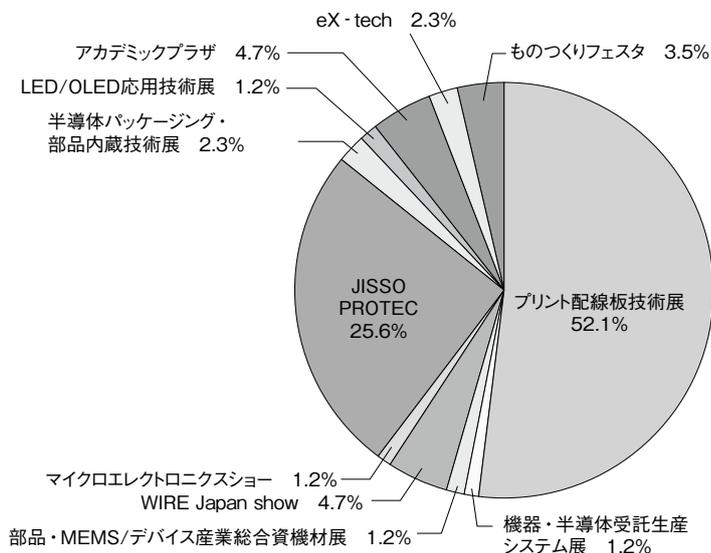
## 12 出展者アンケート調査結果

アンケート調査依頼数: 500社  
 回答数: 202件  
 回答率: 40.4%

1) 今回の展示会全体の印象についてお聞かせ下さい。( )前回数値



2) 今回ご出展を頂きました展示会を次よりお選び下さい。

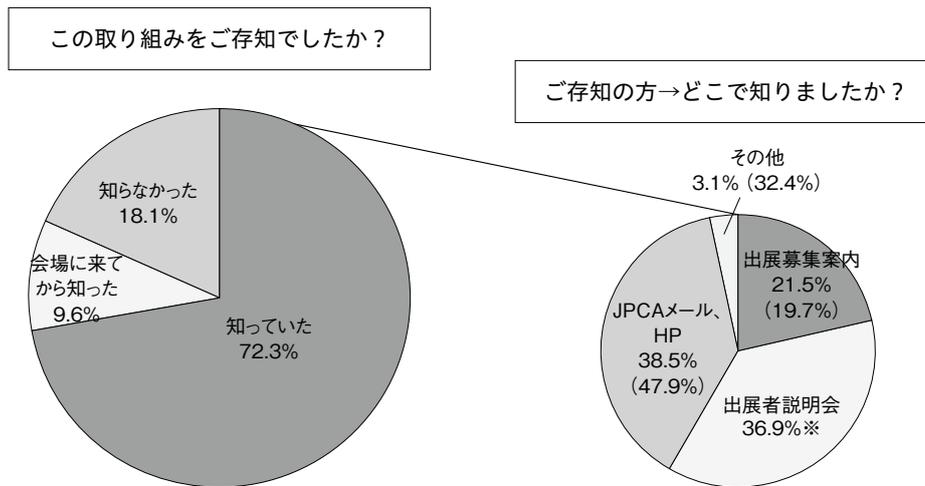


### 3) 本年の取り組みについて

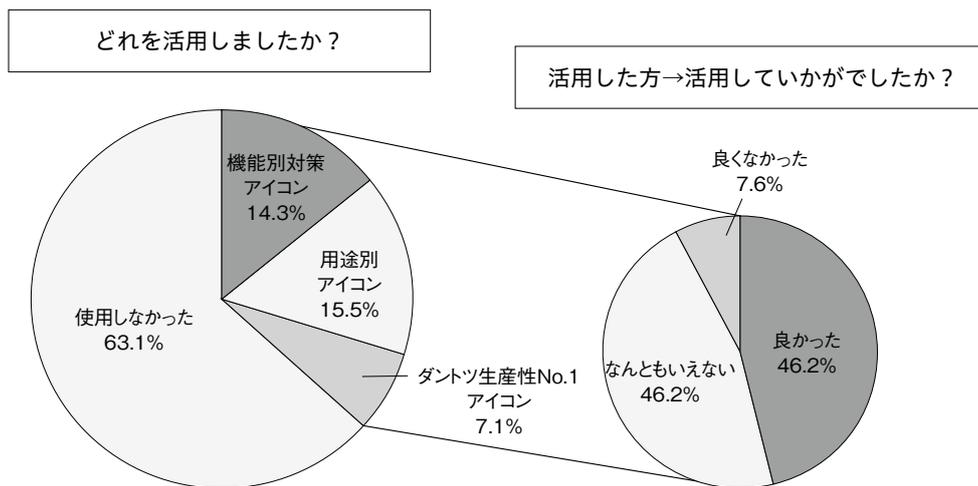
(1) 来場者がわかりやすくブースを回れるよう、機能別、用途別、またダントツ生産性PRアイコン等ご用意致しました。

( ) 前回数値

※新規項目

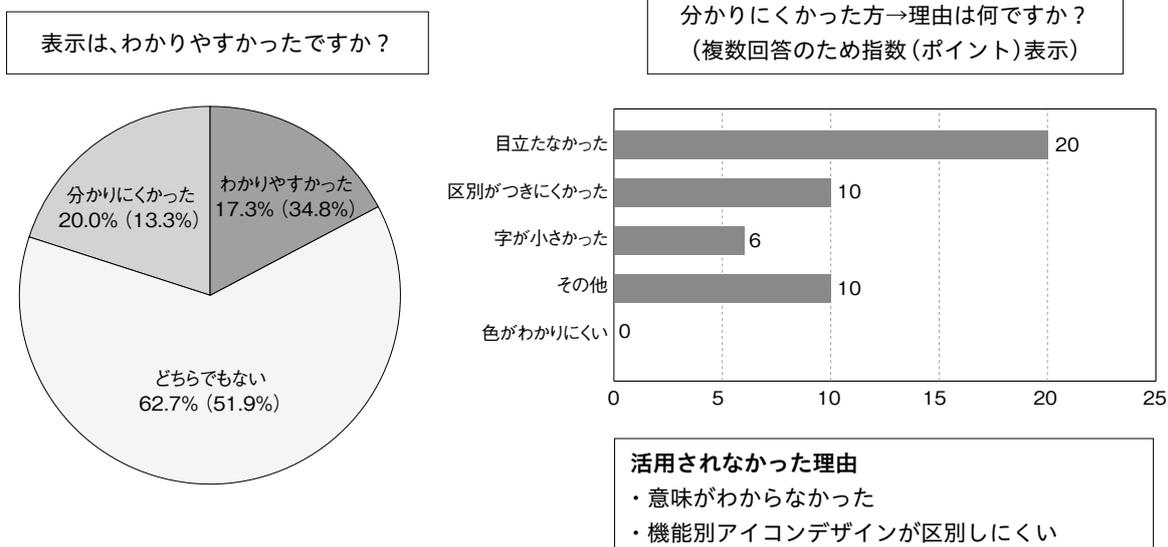


(2) 来場者がわかりやすくブースを回れるよう、機能別、用途別、またダントツ生産性PRアイコン等ご用意致しました。



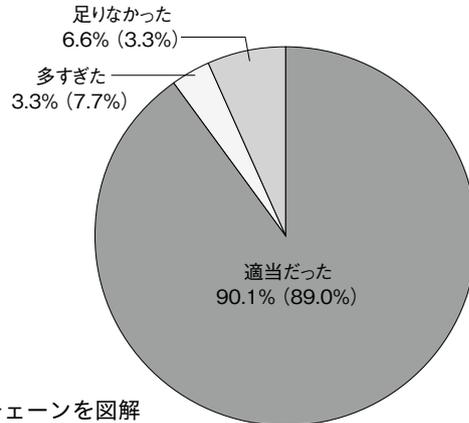
(3) 機能別対策技術、用途別、ダントツ生産性アイコン、出展別区分について、フロアマップに掲載しておりました。

( ) 前回数値



(4) 機能別対策技術(6種)、用途別(6種)、過不足ございませんでしたでしょうか？

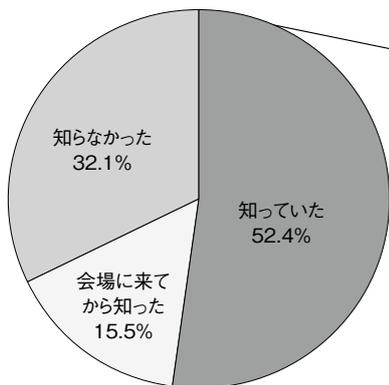
( ) 前回数値



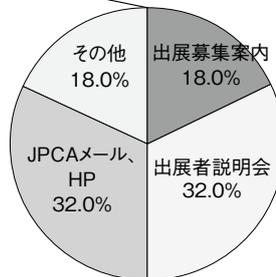
#### 4) 展示会コンセプトについて伺います。

(1) ユーザサイドの設計者に電子回路の企画段階から製造工程、出荷までのサプライチェーンを図解させて頂く展示企画。製造フローと出展者ロゴを巨大ボードに掲示、ガレリアに設置致しました。

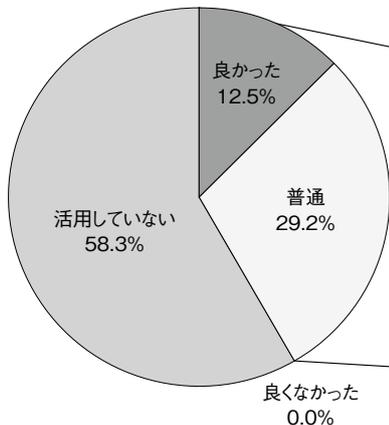
この取り組みをご存知でしたか？



ご存知の方→どこで知りましたか？

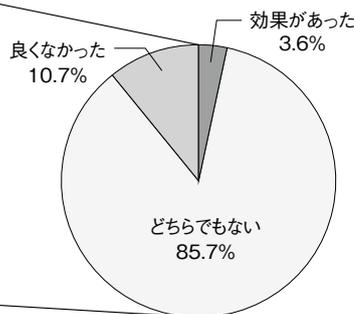


活用されていかがでしたか？

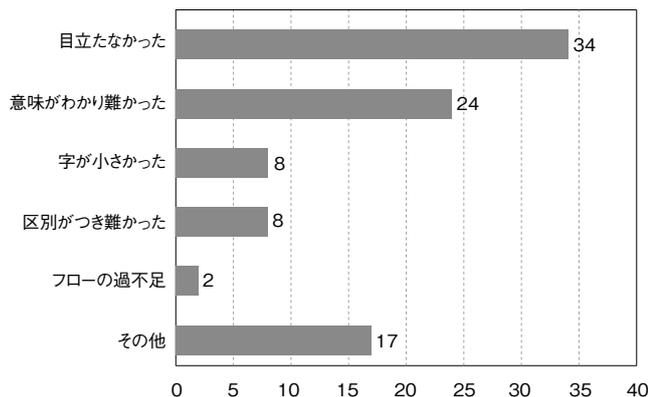


活用された方→

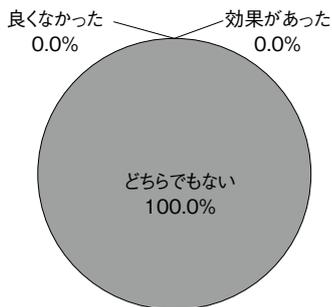
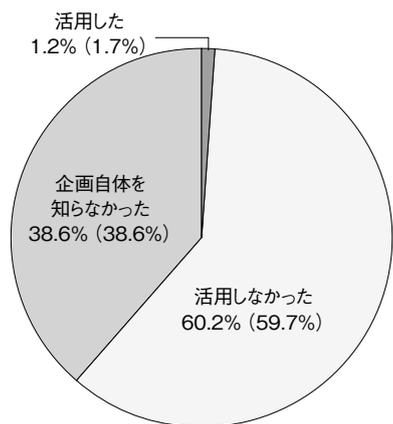
ブースへの来場者誘致に効果はありましたか？



活用されなかった方→今後改善すべき点は何ですか？(複数回答のため指数(ポイント)表示)

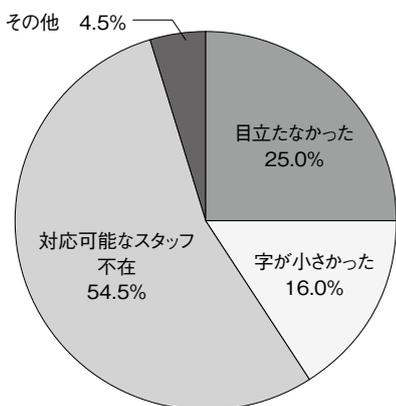


(2) 多言語対応卓上POP (データ提供) を活用されましたか？

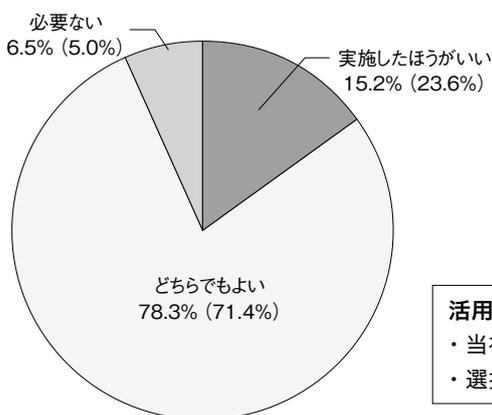


活用された方→  
活用したブースへの来場者誘致に効果はありましたか？

活用されなかった方→理由は何ですか？



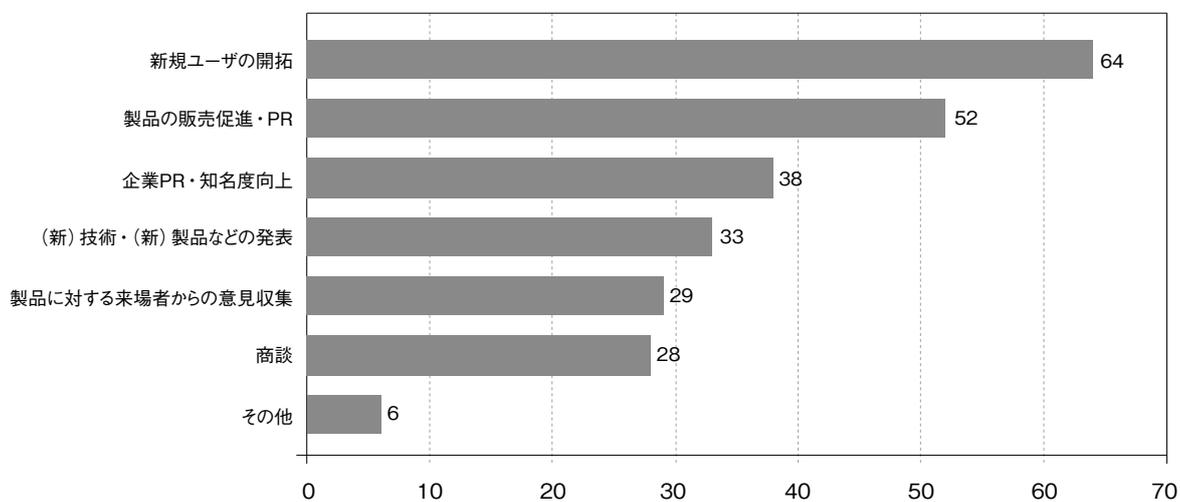
来年も実施した方が良いですか？



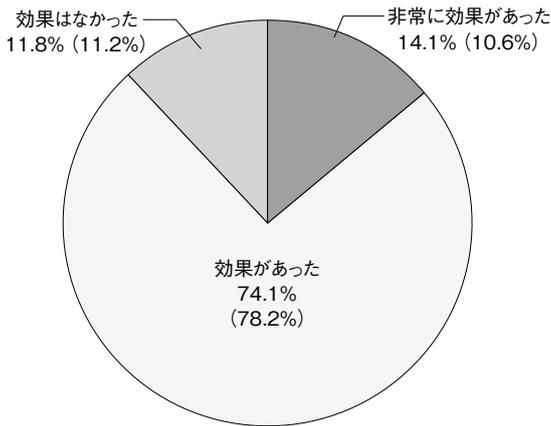
( ) 前回数値

活用しなかった理由  
・ 当社独自の表示を行った為  
・ 選択言語が多すぎるから

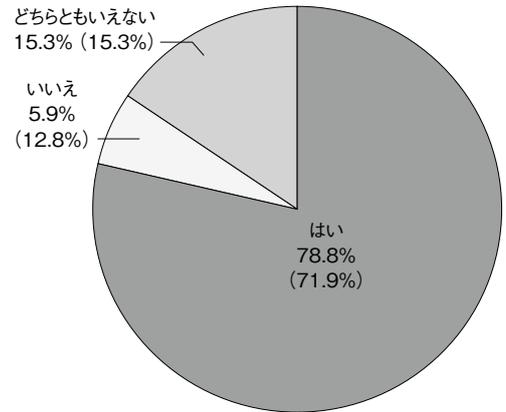
5) ご出展された目的で、次のうち重要度の高いものをお選び下さい。(複数回答のため指数(ポイント)表示)



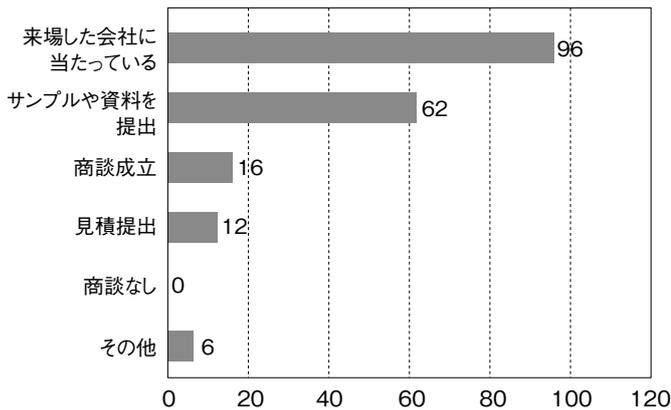
6) ご出展により、貴社が期待した効果がありましたか？ ( )前回数値



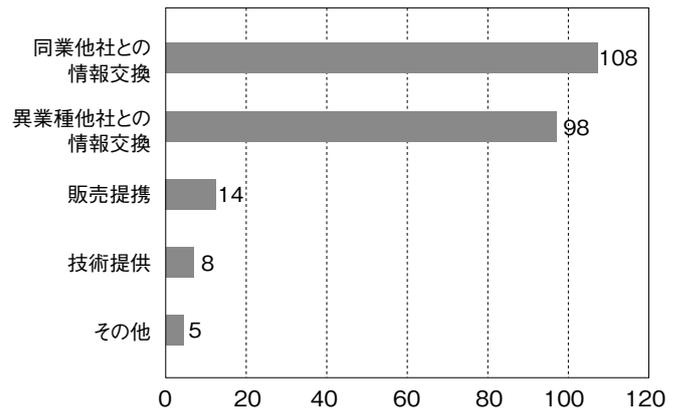
7) 来場者は貴社が期待した業種・分野の方々でしたか？ ( )前回数値



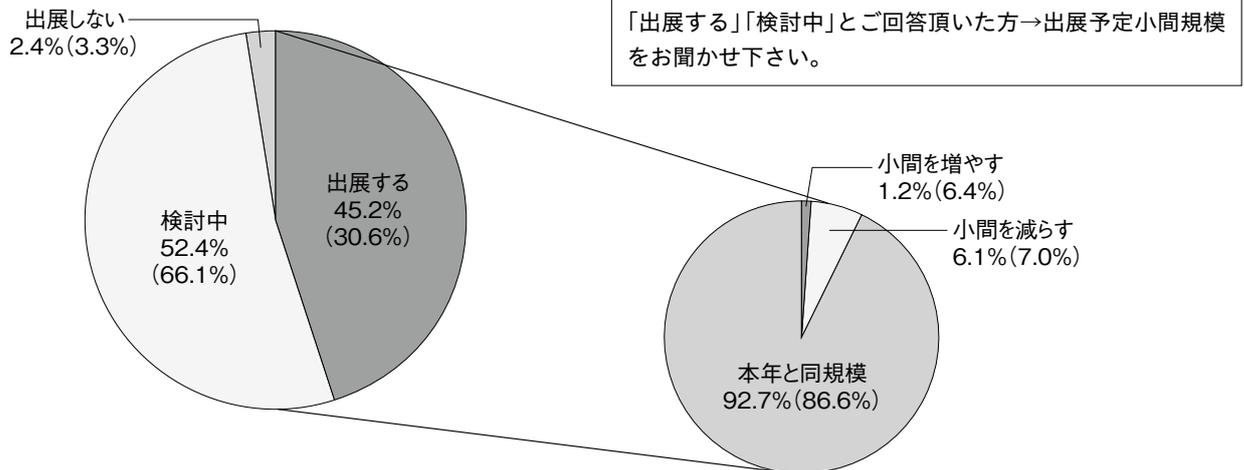
8) 会期中における来場者とのご商談状況について、該当する項目を1つお選び下さい。(複数回答のため指数(ポイント)表示)



9) 会期中におけるご出展者間での交流、商談などについてお聞かせ下さい。(複数回答のため指数(ポイント)表示)



10) 来年開催予定の当展示会(2015年6月3日~5日)への出展予定についてお聞かせください。( )前回数値



# 13 来場者サービス

## ●VIPラウンジ、WECC 訪日団来場者へのサービス

「出展者の顧客招待活動の支援」、「来場者サービス向上の一環」、「決定権者の誘致」等を目的として実施された「VIPラウンジ」を展示会場内に3ヵ所設置。ソフトドリンクなどの飲料や、菓子類のサービスなどを行った。また、海外団体 (WECC : CPCA (中国印制电路板行业协会)、HKPCA (香港線路板協会)、KPCA (韓国電子回路産業協会)、TPCA (台湾电路板協会) が組織する訪日団来場者に対し、各団体事務局が適切なケアを行えるよう、団体専用事務局ルームを設置した。



## ●インターネット・サービス

来場者への利便性を図るために、今回の各ホール入口、VIPルーム、プレスルーム等会場内で「無料インターネット・サービス」を行った。



## ●電子回路サプライチェーンiCON 展示

電子回路基板及び電子回路実装基板の企画から客先への納品までのビジネスフローに基づき、電子回路全体の製造サプライチェーンを図示し、サプライチェーン上に連なる出展者 (希望者) の社名ロゴマーク及び小間番号を表示した日英表記巨大ボードをホール入口付近 (ガレリア内) に設置した。



## ●各種休憩所の設置

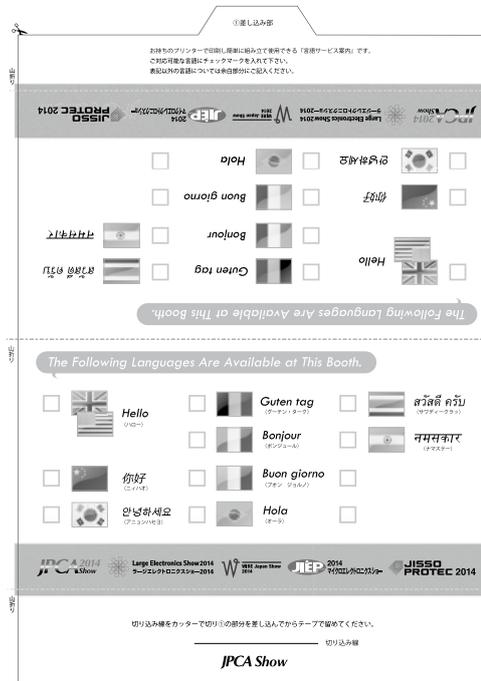
来場者のために、会場各種に休憩できるスペースとともに飲食屋台をご用意。



## ●各ブース対応可能言語卓上POP印刷用データ

出展者サービスとして、簡単に組み上がる「対応可能言語卓上POP印刷用データ」を配信。

「このブースでは、以下の言語を話すスタッフがおります。」の文言の下に、国旗とその言語で「こんにちは」とした。



## ●展示会運営通訳ボランティア

年々増加する海外来場者と出展者とのコミュニケーションがスムーズに行われる事を目的とし、両者の懸け橋となるべく通訳ボランティアを募集。展示会主催団体会員の方々にご協力頂いた。

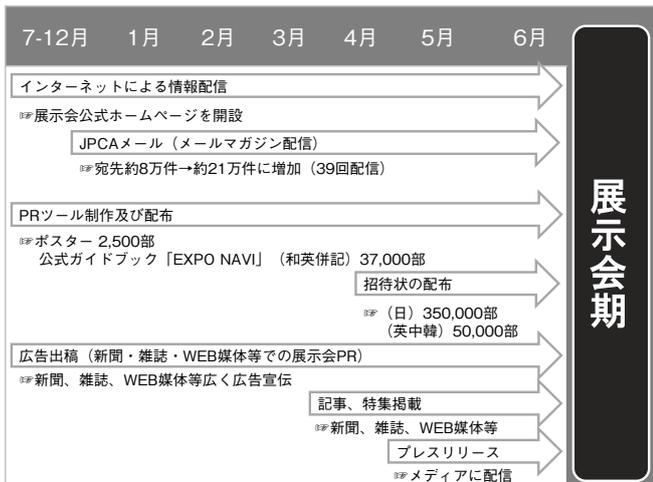
**Interpreting service for visitors**

Please come to the Management Office at East Hall 2 If you would like an volunteer interpreter of the following language. (Max. 1 hour available)

## ●プレスルームの設置

ご来場頂いたプレスの方に利用して頂けるよう、プレスルームを設置。出展者資料設置のほか、インターネット接続環境、ドリンク、お菓子等を提供した。





## (1) 展示会公式サイト

- 開催概要や各種併催企画情報
  - お客様が望む出展製品や技術情報
  - ◎出展者の出展製品・お取り扱い製品などの詳細な情報、出展者検索サイトの充実（検索：展示会別、出展者名、出展製品別、新製品、実演デモ、展示技術、キーワード）
- 本年度6つの機能別展示区分【高放熱・高耐圧対策技術、高速/高周波・低周波（EMI/EMC）対策技術、部品内蔵/3次元PKG化対策技術、小型・薄型・軽量化（高密度配線）対策技術、省エネ・省資源対策技術、低コスト化対策技術】に加え6つの用途別区分【自動車関連、航空・宇宙関連、OA・産業関連、情報・通信関連、AV/家電関連、医療機器関連】や、材料、設備、装置分野で、従来より生産性30%UPをアピールできるダントツ生産性PR出展者の検索をスムーズにできるシステムを設置。また、個別の出展者PRページも設置。出展者情報、製品・技術情報のPRサポートを実施。

- 来場者サービス（アクセス、宿泊案内etc.）



## (2) JPCAメール（メールマガジン）

- ◎JPCAデータベース8万件+産業タイムズ社データベース4万件+SEMIジャパン会員9万件=約21万件に配信
- 2013年10月より展示会期まで、毎週1～3通、定期的に約21万人に配信
- 展示会情報、セミナー情報、イベント情報etc.



## (3) PRツール制作及び配布

- ポスター 2,500部
- 公式ガイドブック「EXPO NAVI」（和英併記） 37,000部



ポスター



EXPO NAVI

## (4) 招待状（日・英・中・韓）の配布

- 日本語招待状 350,000部
- 英・中・韓国語招待状 50,000部

顧客への案内ツールとして出展者へ無料配布。また、主催者から全国の電子関連機器メーカーや自動車産業、照明関連、流通業、医療機器、化学、通信、遊戯、産業機器などの関連業界やユーザ団体に対し、8万通にのぼるDMを直送した。この他、「出展者の顧客招待活動の支援」、「来場者サービス向上の一環」、「決定権者の誘致」を目的として、VIP招待状を発行した。



日本語招待状

VIP招待状

英・中・韓国語招待状

## (5) 広告出稿

（新聞・雑誌・WEB媒体等での展示会PR）、記事・特集掲載

半導体産業新聞、EMSOneウェブサイト、海外姉妹団体（中国CPCA・韓国KPCA・台湾TPCA）の機関誌、JARA、JIEP（学会誌用）、JPCA NEWS、Gichoコミュニケーションズ（メカトロニクス）、インコム、日経産業新聞、経済産業調査会（経済産業公報）、電子ジャーナル、電波新聞、日刊フォーラム、日刊工業新聞、日本鍍金新報、協賛団体etc.

※次ページに広告掲載媒体（新聞・雑誌）の写真を掲載しています。



## 15 スポンサーシップ NEW

より展示会をご活用頂き易いように、新たにスポンサーを募集した。約12万人の来場者へ広くアピール頂けるスポンサー特典をいくつか用意した。

### ゴールドスポンサー (順不同)

日本メクトロン(株)/日本オルボテック(株)/山下マテリアル(株)/メルテックス(株)/伊原電子工業(株)/榎大日光・エンジニアリング/日本ケイデンス・デザイン・システムズ社/ (株)サトーセン/深瀬商事(株)/eSurface社/住友ベークライト(株)

### シルバースポンサー

イー・エス・アイ・ジャパン(株)



### ゴールドスポンサー

MekTEC®

Orbotech.  
Be Sure™

YAMASHITA  
MATERIALS

Link to X  
Meltex

IHARA  
Electronics

DNE  
DNEko Engineering Co., Ltd.

cadence  
OrCAD™  
CADENCE PCB SOLUTIONS

STS 株式会社 サトーセン  
SITSEN

eSurface

ITC

◆ 住友ベークライト株式会社

### シルバースポンサー

esi

# 16 出展者一覧

アース(株)/アートワーク(株)/アイケイ(株)/(有)アイ・ケー・エム(株)愛工機器製作所/ICL JAPAN(株)/ITEQ Corporation/IPC/IPCA(株)アイン/奥士康集团有限公司(株)アクセル/アサダメッシュ(株)/アサヒエンジニアリング(株)/アサヒ化学研究所/AJUHITEK GLOBAL(株)/アジレント・テクノロジー(株)アスカエンジニアリング/アスカコーポレーション(株)/アストロデザイン(株)/アストロン(株)アズマ/アズワン(株)(株)アセト・ウィッツ(株)アソフ・アルファ(株)厚木ミクロ(株)ADEKA(株)アドテックエンジニアリング/アドテックジャパン(株)(株)アドバンテスト(株)アブリビジョンシステムズ/アポロ電子(株)/アユミ工業(株)/アライアンス・コア(株)荒川化学工業(株)/有明技研(株)/アリストエレクトロニックデザインアソシエイツ(有)/アルス(株)/アルテック(株)/アルパイン(株)/アルファーデザイン(株)/アルファテック(株)/アルパマール日本(株)/アルメックスPE(株)(株)安藤・間/EIPC(有)イー・エイチクリエイト/EMS One/イーオーテック(株)イースタン/イープロニクス(株)(株)イグアス(株)いけうち(株)石井表記/石原ケミカル(株)/Inatech Co., Ltd./伊原電子工業(株)イビデン(株)/イビデン電子工業(株)(株)イワイキ/岩下エンジニアリング(株)/(地独)岩手県工業技術センター(株)インコム/インスパック(株)/インターチップ(株)(株)インターテック/インテグラ(株)/文担自動化有限公司(株)ウエキコーポレーション/衛司特科技股份有限(株)/WECC/上村工業(株)(株)ウェル テストウェア営業部(株)ウェル プラズマ装置営業部/ウノ電機(株)/宇都宮大学 吉原研究室/宇都工研(株)/宇部興産(株)/宇部マテリアルズ(株)(株)エイアルテック/HKPCA/HZO Inc./AT&Sジャパン(株)/ATSジャパン(株)/エイテックテクトロン(株)(株)エイ工業(有)エー・アイ・ティ(株)エーアイテック/エーエスエム・アッセンブリー・システムシンガポール/エーエスエム・アッセンブリー・テクノロジー(株)(株)AJ/エーティージー ルーサー アンド メルツァー(有)エービーシー/揚宣電子有限公司(株)SIJテクノロジー(株)SHカッパープロダクツ/SHマテリアル(株)(株)エス・エム・シー(株)エスケーエレクトロニクス/エスティケイテクノロジー(株)(株)SPF(株)エスユーエス/NTW Inc.(株)(株)エヌビーシー(株)エノモト/エビナ電化工業(株)/FMS Force Measuring Systems AG./エフビー実業(株)エポックサイエンス(株)エム・アイ・エステクノロジー(株)/MFS TECHNOLOGY (PCB) CO., LTD.(株)エム・シーケ/エムシステム(株)(株)エムリンク/エルテック(株)/LPKF Laser & Electronics (株)/Elec & Eltek Multilayer PCB Limited/(一社)エレクトロニクス実装学会/尾池工業(株)(株)OMT/AUGUST STRECKER GmbH & Co. KG.(株)オーグ製作所(株)オーケープリント/大阪府立大学大学院研究科 物質化学系専攻分子認識化学研究グループ/大船企業日本(株)(株)オーロテック/オカダジーエージェイ(株)沖エンジニアリング(株)オキモ(株)沖電線(株)奥野製薬工業(株)奥原電気(株)オメガセミコン電子(株)オリオン機械(株)オリジン電気(株)オルガン針(株)ガーディアンジャパン(株)カールツァイスマイクロスコピー(株)Kaige Group Co., Ltd./花王(株)科恵(澳門離岸商業服務)線路有限公司/化研テック(株)鹿児島県産業立地課/嘉世通企業有限公司(株)カマタテクニカランスポート/神奈川県工科大学 小室研究室/神奈川県工科大学 小室研究室 大学院電気電子工学専攻/カナン精機(株)(株)カネカ/川崎重工業(株)カワムラ精機(株)/関西電貨(株)関西分科会/関東学院大学工学研究科 山下研究室/関東学院大学 小岩研究室/関東学院大学 材料・表面工学研究所/関東学院大学 理工学部 応用化学コース 小岩研究室/紀州技研工業(株)北川精機(株)(公財)北九州産業学術推進機構半導体技術センター/Gicho ビジネスコミュニケーションズ(株)/キャリア・デベロップメント・アソシエイツ/国立大学法人九州工業大学/(公財)九州先端科学技術研究所/九州大学 ナノ・マイクロ工学研究室/九州工科大学 エレクトロニクス/イノベーション協議会/協栄プリント技研(株)(株)京写(株)キンレイ/クアドセプト(株)(株)久世ペロローズ工業所/邦田工業(株)(株)くまもとメクス/熊本県/熊本県産業技術センター/(一社)組込みシステム技術協会/Cloud Testing Service(株)/倉敷紡績(株)/クリテックサービス(株)(株)グローブ・テック/群馬大学 先端科学研究指導者育成ユニット/群馬大学理工学研究院 白石研究室/群翔工業股份有限公司/ケイレックス・テクノロジー(株)/KPCA(株)ケー・ブラッシュ商会/ケルセル(株)(株)ケミトロン/ケムチュラ・ジャパン(株)/ケンマージャパン(株)(株)コアーズ(株)工業通信/神津精機(株)神戸製鋼所/神戸大学大学院 理学研究科 木村研究室/興和電子工業(株)/KOA(株)/互応化学工業(株)/コーベックス(株)(株)コーンテクノロジー/GOAL SEARCHERS CO., LTD. ZHUHAI/悟空(株)/国際技術開発(株)/国士館大学 越地研究室/小島化学薬品(株)(株)コスミック/コスモサウンド(株)藤藤製作所/コネクテックジャパン(株)/KOLON Industries, Inc.(株)サーマプレジジョン(株)サイバークラフトソリューション/栄電子工業(株)相模ビーシーアイ(株)櫻井精機(株)(株)ササキ(株)サヤカ/山栄化学(株)三共化成(株)産業技術総合研究所/三共精密金型(株)(株)産業創成アドバイザリー/株産業タイムズ社/三晃技研工業(株)(有)サンユー機工/サンユー工業(株)山陽精工(株)(株)サンヨー工業/三立興産(株)サンワ化学工業(株)三和電子機器(株)三和電子サーキット(株)三和ニューテック(株)ジーエスアイ・グループ・リミテッド(株)ジー・キューブ/CKD(株)(株)シーズ(有)(株)シーデックス/CPCA/シーマ電子(株) Cuprime Material Co., Ltd.(株)シェアード・ソリューション・サービス/JX日鉱日石金属(株)ジェイムテクノロジー(株)(株)JCU/J-RAS(株)/JPCA/ジ・エス・エム・シー・ジャパン(株)/SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD./SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD./SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY CORP./Shenzhen Newcess Industrial Co., Ltd./ジオマテック(株)(株)シキノ/テック(株)シグナス/(有)シグマトップ/四国化成工業(株)SIKORA AG-GERMANY/(有)シスコム(株)システムLSIセンター/シチズンファインテックミヨタ(株)(株)シブス/シナジーオプティクス(株)/Shimada Appli 合同会社(株)島津製作所/JADASON Enterprises Ltd./ジャパンコム(株)ジャパンマテリアル(株)(株)ジャパンユニックス/ジャプロ工業(株)Shanghai Nanya Copper Clad Laminate Co., Ltd./JUKI(株)臭素科学・環境フォーラム(BSEF)/SCHMID CHINA LTD./シュモール・マシネン/昭光通商(株)昭和電工(株)ショーダテクトロン(株)シライ電子工業(株)シレゴテクノロジージャパン(株)(株)シニアベックス/晋一化工股份有限公司/信越石英(株)神鋼リードミック(株)信州大学先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室(株)シンセン/ズース・マイクロテック(株)ZHUHAI ATEM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.(株)函研(株)スズキ(株)鈴木商館/ステイ電子機器(株)ステラ(株)(株)ステラ・コーポレーション/株ストラテジー/スピンドバステクノロジーセンター/住友重機械工業(株)(株)スリーポンド/Zumbach Electronic AG/セイコーインスツル(株)(株)清和光学製作所/積水化学工業(株)CEDAL EQUIPMENT SRL(株)セミコンダクター・タル/SEMIジャパン(株)セミテックインターナショナル/ゼン・オウルズ(株)センサーコントロールズ(株)千住金属工業(株)(株)センズ/双日プラネット(株)(有)双明通信機製作所(株)Sohwa & Sophia Technologies(株)ソフミックス/ソマル(株)嵩台資訊股份有限公司/第一工業製薬(株)第一通信工業(株)台強電機日本(株)/大道産業(株)ダイナトロン(株)大日工業(株)大日本スクリーン製造(株)大日本スクリーン製造(株)(G10)/台豊印刷回路工業股份有限公司/Timetech/太陽インキ製造(株)大洋工業(株)太陽工業(株)太陽電機産業(株)(株)ダイワ(株)高田工業所(株)タカハタ電子/タガシール工業(株)タカヤ(株)(株)タキモト(株)タキロン 高機能材事業部(株)タケウチ/竹田印刷(株)田代電化工業(株)タツタ電線(株)タナーリサーチジャパン(株)(株)タムラ製作所(株)タム・タクマ(株)ちの技研/China Circuit Technology (Shantou) Corporation/(一社)中部産業連盟/中部分科会/チュール(株)長興化学工業(株)(株)角田プラン製作所/(有)ディアックス/TR(HK)COMPANY LIMITED/TEGサービス(株)DKSHジャパン(株)ティーシーティ・ジャパン(株)/TDK(株)TPCA/DMカードジャパン(株)(株)テクノアセルネットワークス/テクノアシスト(株)テクノアルファ(株)テクノサポート/テストバンク(株)TAESUNG CO., LTD./デュボン(株)日電精密工業(株)ニッカン工業(株)日刊工業新聞社/日経BP/日広鋼機(株)日産化学工業(株)(株)ニッシン/日進化成(株)日総工産(株)ニツタ(株)(株)日放電子/(株)二宮システム/日本アグファマテリアル(株)日本アビオニクス(株)日本EDAベンチャー連絡会/日本エバレット・チャールズ(株)日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ(株)日本オートマチックマシン(株)日本オルボテック(株)(株)日本金属化工所(株)日本工業新聞社/NPO法人日本情報技術取引所/日本高純度化学(株)日本サーキット工業(株)日本シイエムケイ(株)(株)日本スベリア社/日本ゼオン(株)日本大学理工学部 内木場・齊藤研究室/日本テック(株)日本テック(株)日本電気(株)日本電気硝子(株)日本電産(株)(一社)日本電子回路工業会/(一社)日本電子デバイス産業協会/日本電熱(株)日本トムソン(株)日本ファインテック(株)日本フイルコン(株)日本ポリテック(株)日本マクダーミッド(株)日本マルコ(株)日本ミクロン(株)日本ミルテック(株)日本メトロ(株)(一社)日本ロボット工業会(株)ニッコ/ノードン(株)(株)野毛電気工業(株)野田スクリーン/NovaCentrix社/野村リサーチ・アンド・アドバイザリー(株)PARK ELECTROCHEMICAL CORP./ハーディング(株)ハイウイン(株)Biopro. Co., Ltd./BAOJI AATI NEW METAL CO., LTD./Baoji Special Steel Titanium Industry Co., Ltd./伯東(株)パソコン(株)(株)パターンアート研究所/白光(株)/八光電子工業(株)パナソニック(株)パナソニック AIS社/パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)ハニ化成(株)(有)ハラサケス/和仁貿易/PAN-TEC CORPORATION LIMITED/NPO法人 半導体目利きボード(STM)/ピアメカニクス(株)(株)ピーバンドットコム(株)ピームセンス/日置電機(株)順浩科技股份有限公司/日立化成(株)日立化成商事(株)日立金属(株)日立立ハイクインシステムズ(株)日立立ハイクサイエンス(株)平山ファインテック/ヒロセ電機(株)ファーストゲイト(株)ファーマネス(株)ファインテック/ファブインシステムズ(株)ファルコン電子(株)(株)フィッシャー・インシステムズ(株)ブイ・テクノロジー/深瀬商事(株)(公財)福岡県産業・科学技術振興財団/福岡金属箔工業(株)富士加工紙(株)富士機械製造(株)富士機工(株)フジクラ/富士通(株)富士通インターコネクトテクノロジーズ(株)(有)フジテクニカル/富士回路科技(香港)/富士フイルムグループ/バルグラフィックスシステムズ(株)富士プリント工業(株)(株)ブライマテック(株)ブラスマイオンアシスト/ブラメックス(株)フリージア・オート技研(株)(株)ブリマックス(株)プリント回路ジャーナル/古河精密金属工業(株)古河電気工業(株) burster praezisionsmesstechnik gmbh & co. kg(株)ブロッセス・ラボ・ミクロン(株)ベック/BETA LASER MIKE INC./ヘラインダストリーズ/ヘラマシヤイトン(株)(地独)北海道立総合研究機構(株)堀場エステック(株)堀場製作所/マイクロクラフト(株)/マイクロテック ラボラトリーズ/マイクロニクス・マイデータ・ジャパン(株)(株)マクニカ/松定プレジジョン/マッコリキャピタル証券会社(株)丸源鉄工所(株)丸マルコム(株)丸マルチタスク/カンパニー/丸文(株)(株)ミズサワセミコンダクタ/三菱ガス化学(株)三菱伸銅(株)三菱電機(株)三菱電機メテックス(株)ミナミ(株)ミノインターナショナル(株)(株)ミノグループ/武蔵エンジニアリング(株)(株)ムラキ(株)村田製作所/明治大学理工学部 機械工学科 計測情報研究室/明星大学連携研究センター/名東電産(株)明和化成(株)(株)メガテック/めっき委員会/メック(株)メテック(株)MEBACS(株)メルムス・コア/メルテックス(株)メスグリオ(株)メンター・グラフィックス・ジャパン(株)(株)モトニクス/森川産業(株)山勝電子工業(株)山下マテリアル(株)ヤマトマテリアル(株)(株)ヤマトヤ商会/山梨アビオニクス(株)ヤマハ発動機(株)ヤマハ発動機 IM事業部 アイバルスビジネス部/ヤマハファインテック(株)Uwin Nanotech. Co., Ltd./ユキヤマコ・ジャパン/UTホールディングス(株)(株)ユニテクノロジー(株)UBIC/パテンパートナーズ/ユニオンツール(株)ユニクラフト(株)ユニチカ(株)ユニテック/ユニテック・ジャパン(株)/Unitek Maschinenbau-und Handels GmbH./ユニテックジャパン(株)ユニバーサルPCB設備有限公司(株)吉川アルエフセミコン/吉野川電線(株)米沢ダイエレクトロニクス(株)/リードエグジビジョンジャパン(株)(株)リョウ電子デバイスカンパニー/利昌工業(株)リソテックジャパン(株)/RITAエレクトロニクス(株)RITAエレクトロプロダクツ(株)(株)リアデザイン/LiangDar Technology Co., Ltd.(株)菱光社(株)リョウワ/凌和電子(株)山形工業/RaiYiTeck Hit-Check Film Co., LTD./Shenzhen REVISION(株)(株)レヒオン工業/連結機械股份有限(株)/Rosendahl Maschinen GmbH/ローム(株)ローム・アンド・ハース電子材料(株)(株)ダウ・ケミカルグループ/碌々産業(株)株ロジック・リサーチ/六甲電子(株)株ロムテック(株)ワイ・エムテクノロジー(株)ワイ・ディー・シー/早稲田大学 応用化学科 本間研究室/早稲田大学 情報生産システム研究センター 先進材料研究室

## 2014展示会運営委員会 委員リスト

委員長	山本 治彦 (展示会企画委員会委員長/JPCA副会長)
副委員長	曾谷 太 (JPCA理事/ソマール株) 四津 三樹男 (ピアメカニクス株)
委員	須賀 唯知 (JIEP会長/東京大学教授) 土門 孝彰 (JIEP展示事業委員会委員長/TDK株) 曾我 信之 (JISSO PROTEC 2014 運営委員長/富士機械製造株) 泉谷 渉 (ラージエレクトロニクスショー共催会社代表/株産業タイムズ社) 井上 政基 (WIRE Japan Show 共催会社代表/株工業通信)

## 展示会企画委員会 委員リスト

委員長	山本 治彦 (JPCA副会長)
委員	青山 雅之 (株デンソー) 後藤 哲朗 (株ニコン) 松本 博文 (日本メクトロン株) 須賀 唯知 (東京大学教授) 土門 孝彰 (TDK株) 福島 秀明 (株日立ハイテクインスツルメンツ) 武野 祐丸 (富士機械製造株) 泉谷 渉 (株産業タイムズ社) 兼子 昌和 (日本メクトロン株) 川村 準 (株工業通信)

## JPCA活性化委員会 委員リスト

委員長	岩城 慶太郎 (メルテックス株)
副委員長	兼子 昌和 (日本メクトロン株)
委員	高見澤 栄治 (ソマール株) 杉山 峰雄 (福田金属箔粉工業株)

## JIEP展示事業委員会 委員リスト

委員長	土門 孝彰 (TDK株)
副委員長	宝蔵寺 裕之 (株日立製作所)

## 最先端実装技術シンポジウムWG

委員長	小日向 茂 (大阪大学)
副委員長	米田 泰博
委員	齊藤 雅之 (株東芝) 天明 浩之 (株日立製作所) 高野 希 (日立化成株) 柳町 成行 (日本電気株) 内海 裕一 (兵庫県立大学) 西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援) 金子 俊之 (京セラサーキットソリューションズ株) 猪川 幸司 (日本シイエムケイ株) 内木場 文男 (日本大学) 荘司 郁夫 (群馬大学)
アドバイザー	本多 進 (C-NET) 和嶋 元世 (株JCU) 田畑 晴夫 (大阪大学)

## アカデミックプラザWG

委員長	小岩 一郎 (関東学院大学)
副委員長	白石 洋一 (群馬大学)
委員	澤田 廉士 (九州大学)

## 展示イベント企画運営WG

委員長	平田 勝子 (霞テクノロジー株)
-----	------------------

## JISSO PROTEC 2014 運営委員会 委員リスト

委員長	曾我 信之 (富士機械製造株)
副委員長	富士原 寛 ((一社)日本ロボット工業会)
委員	永嶋 弘和 (JUKI株) 尾本 勝彦 (パナソニック ファクトリーソリューションズ株) 河崎 勝浩 (株日立ハイテクインスツルメンツ) 藤田 宏昭 (ヤマハ発動機株)

## JISSO PROTEC 2014 実行委員会 委員リスト

委員長	武野 祐丸 (富士機械製造株)
副委員長	福島 秀明 (株日立ハイテクインスツルメンツ)
委員	上田 裕司 (JUKI株) 西村 勤 (パナソニック ファクトリーソリューションズ株) 彦野 光芳 (ヤマハ発動機株) 遠藤 誠 (千住金属工業株) 辻村 武彦 (マイクロニック・マイデータ・ジャパン株) 矢内 重章 ((一社)日本ロボット工業会)

## JISSO PROTEC 2014 企画部会 委員リスト

部長	武野 祐丸 (富士機械製造株)
副部長	福島 秀明 (株日立ハイテクインスツルメンツ)
委員	上田 裕司 (JUKI株) 西村 勤 (パナソニック ファクトリーソリューションズ株) 彦野 光芳 (ヤマハ発動機株)

## 展示会運営協力員

池田 猛	(日本シイエムケイ株)
島田 修志	(奥野製薬工業株)
内田 幸一	(日本オルボテック株)
斎藤 誠	(太陽ホールディングス株)
由井 修	(株JCU)
加治屋 篤	(日本メクトロン株)
飯野 泰成	(日本メクトロン株)
徳田 博	(上村工業株)
桜井 洋文	(株フジクラ)

(順不同・敬称略)

**JPCA 2014 Show**  
第44回国際電子回路産業展  
44th International Electronic Circuits Exhibition  
主催：一般社団法人日本電子回路工業会  
Sponsored by JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association



ラージエレクトロニクスショー2014  
主催：一般社団法人日本電子回路工業会・半導体産業新聞(産経ウイメンズ)  
Co-Sponsored by:  
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association  
The Semiconductor Industry News (Sanjyo Times, Inc.)  
**Large Electronics Show 2014**



**WIRE Japan Show 2014**  
電線・ケーブル・コネクタ総合技術展  
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞(株)工業通信



2014  
マイクロエレクトロニクスショー  
第28回 最先端実装技術・パッケージング展  
28th ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION  
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)  
Sponsored by: JIEP Japan Institute of Electronics Packaging



**JISSO PROTEC 2014**  
第16回 実装プロセステクノロジー展  
16th Jisso Process Technology Exhibition  
主催：一般社団法人日本ロボット工業会  
Sponsored by: JARA Japan Robot Association (JARA)

**JPCA**

一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

TEL (03) 5310-2020 FAX (03) 5310-2021

<http://jpca.jp>